

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005554

International filing date: 25 March 2005 (25.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-100933
Filing date: 30 March 2004 (30.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 3 0 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 1 0 0 9 3 3

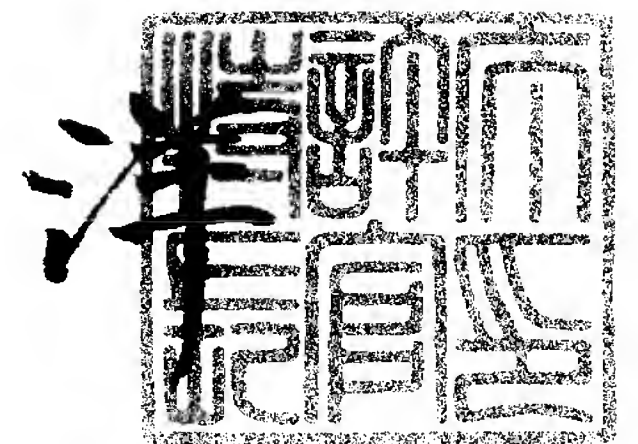
パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 1 0 0 9 3 3
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): 浜 松 ホ ト ニ ク ス 株 式 会 社

2 0 0 5 年 4 月 2 0 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】	特許願
【整理番号】	2003-0851
【提出日】	平成16年 3月30日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	B23K 26/00
【発明者】	
【住所又は居所】	静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社 内
【氏名】	坂本 剛志
【発明者】	
【住所又は居所】	静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社 内
【氏名】	福満 憲志
【特許出願人】	
【識別番号】	000236436
【氏名又は名称】	浜松ホトニクス株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100088155
【弁理士】	
【氏名又は名称】	長谷川 芳樹
【選任した代理人】	
【識別番号】	100092657
【弁理士】	
【氏名又は名称】	寺崎 史朗
【選任した代理人】	
【識別番号】	100124291
【弁理士】	
【氏名又は名称】	石田 悟
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	014708
【納付金額】	21,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

複数の機能素子を含む積層部が表面に形成された基板の内部に集光点を合わせてレーザー光を照射することで、前記基板の切断予定ラインに沿って、切断の起点となる改質領域を前記基板の内部に形成するレーザー加工方法であって、

前記切断予定ラインに沿った第 1 の改質領域を複数列形成する工程と、

前記基板の裏面に最も近い前記第 1 の改質領域と前記裏面との間の位置に、前記切断予定ラインに沿った第 2 の改質領域を少なくとも 1 列形成することで、前記切断予定ラインに沿った割れを前記第 2 の改質領域から前記裏面に生じさせる工程とを含むことを特徴とするレーザー加工方法。

【請求項 2】

前記基板は半導体基板であり、前記第 1 の改質領域及び前記第 2 の改質領域は溶融処理領域を含むことを特徴とする請求項 1 記載のレーザー加工方法。

【請求項 3】

前記第 1 の改質領域及び前記第 2 の改質領域は、前記裏面をレーザー光入射面として、前記裏面から遠い順に一例ずつ形成されることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のレーザー加工方法。

【請求項 4】

前記第 1 の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーは $2\ \mu\text{J} \sim 50\ \mu\text{J}$ であることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか一項記載のレーザー加工方法。

【請求項 5】

前記第 2 の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーは $1\ \mu\text{J} \sim 20\ \mu\text{J}$ であることを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか一項記載のレーザー加工方法。

【請求項 6】

前記第 1 の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーは、前記第 2 の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーより大きいことを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか一項記載のレーザー加工方法。

【請求項 7】

前記第 2 の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーを 1 とした場合、前記第 1 の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーは $1.6 \sim 3.0$ であることを特徴とする請求項 6 記載のレーザー加工方法。

【請求項 8】

隣り合う前記第 1 の改質領域のそれぞれを形成する際にレーザー光の集光点を合わせる位置間の距離は $24\ \mu\text{m} \sim 70\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 ～ 7 のいずれか一項記載のレーザー加工方法。

【請求項 9】

前記第 1 の改質領域を形成する際にレーザー光の集光点を合わせる位置の前記裏面からの距離は $50\ \mu\text{m} \sim [(\text{前記基板の厚さ}) \times 0.9]\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 ～ 8 のいずれか一項記載のレーザー加工方法。

【請求項 10】

前記第 2 の改質領域を形成する際にレーザー光の集光点を合わせる位置の前記裏面からの距離は $20\ \mu\text{m} \sim 110\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 ～ 8 のいずれか一項記載のレーザー加工方法。

【請求項 11】

前記基板及び前記積層部を前記切断予定ラインに沿って切断する工程を更に含むことを特徴とする請求項 1 ～ 10 のいずれか一項記載のレーザー加工方法。

【請求項 12】

基板と、機能素子を含んで前記基板の表面に形成された積層部とを備える半導体チップであって、

前記基板の側面には、前記基板の厚さ方向において一続きとなるように、前記裏面に沿

った第 1 の改質領域が複数列形成されており、

前記側面において、前記裏面に最も近い前記第 1 の改質領域と前記裏面との間の位置には、前記裏面に沿った第 2 の改質領域が少なくとも 1 列形成されていることを特徴とする半導体チップ。

【請求項 1 3】

前記基板は半導体基板であり、前記第 1 の改質領域及び前記第 2 の改質領域は溶融処理領域を含むことを特徴とする請求項 1 2 記載の半導体チップ。

【請求項 1 4】

対向する前記第 1 の改質領域の裏面側端部と前記第 2 の改質領域の表面側端部との距離は $15\ \mu\text{m} \sim 60\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 2 又は 1 3 記載の半導体チップ。

【請求項 1 5】

前記基板の厚さ方向における前記第 1 の改質領域の幅の合計は $40\ \mu\text{m} \sim [(\text{前記基板の厚さ}) \times 0.9]\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 2 ～ 1 4 のいずれか一項記載の半導体チップ。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 レーザ加工方法及び半導体チップ

【技術分野】

【 0 0 0 1 】

本発明は、複数の機能素子を含む積層部が形成された基板を切断するために使用されるレーザ加工方法、及びそのようなレーザ加工方法の使用により切断された半導体チップに関する。

【背景技術】

【 0 0 0 2 】

従来におけるこの種の技術として、ウェハ状の加工対象物の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することで、切断予定ラインに沿った改質領域を加工対象物の内部に複数列形成し、その改質領域を切断の起点とするというレーザ加工方法がある（例えば、特許文献 1 参照）。

【特許文献 1】 特開 2 0 0 2－2 0 5 1 8 0 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 3 】

上述したようなレーザ加工方法は、加工対象物が厚い場合に特に有効となる技術である。このような技術に関連し、複数の機能素子を含む積層部が形成された基板を加工対象物とし、その基板が厚い場合にも、基板及び積層部の高精度な切断を可能にする技術が望まれていた。

【 0 0 0 4 】

そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、複数の機能素子を含む積層部が形成された基板が厚い場合であっても、基板及び積層部の高精度な切断を可能にするレーザ加工方法、及びそのようなレーザ加工方法の使用により切断された半導体チップを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 5 】

上記目的を達成するために、本発明に係るレーザ加工方法は、複数の機能素子を含む積層部が表面に形成された基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することで、基板の切断予定ラインに沿って、切断の起点となる改質領域を基板の内部に形成するレーザ加工方法であって、切断予定ラインに沿った第 1 の改質領域を複数列形成する工程と、基板の裏面に最も近い第 1 の改質領域と裏面との間の位置に、切断予定ラインに沿った第 2 の改質領域を少なくとも 1 列形成することで、切断予定ラインに沿った割れを第 2 の改質領域から裏面に生じさせる工程とを含むことを特徴とする。

【 0 0 0 6 】

このレーザ加工方法においては、例えば、エキスパンドテープ等の拡張可能フィルムを基板の裏面に貼り付けて拡張させると、切断予定ラインに沿った割れが第 2 の改質領域から基板の裏面に予め生じているため、第 1 の改質領域を介して基板から積層部へとスムーズに割れが進行することとなり、その結果、基板及び積層部を切断予定ラインに沿って精度良く切断することができる。従って、このレーザ加工方法は、複数の機能素子を含む積層部が形成された基板が厚い場合であっても、基板及び積層部の高精度な切断を可能にする。

【 0 0 0 7 】

ここで、機能素子とは、例えば、結晶成長により形成された半導体動作層、フォトダイオード等の受光素子、レーザダイオード等の発光素子、回路として形成された回路素子等を意味する。なお、第 1 の改質領域及び第 2 の改質領域は、基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することで、多光子吸収或いはそれと同等の光吸収を基板の内部で生じさせることにより形成される。

【 0 0 0 8 】

また、上記レーザー加工方法においては、基板は半導体基板であり、第1の改質領域及び第2の改質領域は溶融処理領域を含む場合がある。基板が半導体基板であると、第1の改質領域及び第2の改質領域として、溶融処理領域を含む改質領域が形成される場合がある。

【0009】

また、上記レーザー加工方法においては、第1の改質領域及び第2の改質領域は、裏面をレーザー光入射面として、裏面から遠い順に一つずつ形成されることが好ましい。これにより、各改質領域を形成するに際し、基板の裏面（レーザー光入射面）とレーザー光の集光点との間には改質領域が存在しないため、既に形成された改質領域によるレーザー光の散乱、吸収等が起こることはない。従って、各改質領域を精度良く形成することが可能になる。

【0010】

また、上記レーザー加工方法においては、第1の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーは $2\mu\text{J}\sim 50\mu\text{J}$ であることが好ましい。このような条件で第1の改質領域を形成すると、基板及び積層部の切断時において、第1の改質領域を起点とした割れが切断予定ラインに沿って精度良く発生する傾向があるからである。なお、レーザー光のエネルギーが $2\mu\text{J}$ 未満になると、基板及び積層部の切断時において、第1の改質領域を起点とした割れが発生し難くなる。一方、レーザー光のエネルギーが $50\mu\text{J}$ を超えると、基板及び積層部の切断時において、第1の改質領域を起点とした割れが切断予定ラインから外れ易くなる。

【0011】

また、上記レーザー加工方法においては、第2の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーは $1\mu\text{J}\sim 20\mu\text{J}$ であることが好ましい。このような条件で第2の改質領域を形成すると、第2の改質領域を起点とした割れが基板の裏面に確実に達する傾向があるからである。なお、レーザー光のエネルギーが $1\mu\text{J}$ 未満になると、第2の改質領域を起点とした割れが基板の裏面に達し難くなる。一方、レーザー光のエネルギーが $20\mu\text{J}$ を超えると、基板の裏面に溶融等の損傷が生じ易くなる。

【0012】

また、上記レーザー加工方法においては、第1の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーは、第2の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーより大きいことが好ましく、例えば、第2の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーを1とした場合、第1の改質領域を形成する際のレーザー光のエネルギーは $1.6\sim 3.0$ であることが好ましい。このような条件で第1の改質領域を形成すると、基板及び積層部の切断時において、第1の改質領域を起点とした割れが切断予定ラインに沿って精度良く発生する傾向があるからである。なお、レーザー光のエネルギーが 1.6 未満になると、基板及び積層部の切断時において、第1の改質領域を起点とした割れが発生し難くなる。一方、レーザー光のエネルギーが 3.0 を超えると、基板及び積層部の切断時において、第1の改質領域を起点とした割れが切断予定ラインから外れ易くなる。

【0013】

また、上記レーザー加工方法においては、隣り合う第1の改質領域のそれぞれを形成する際にレーザー光の集光点を合わせる位置間の距離は $24\mu\text{m}\sim 70\mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件で第1の改質領域を形成すると、隣り合う第1の改質領域同士が基板の厚さ方向において一続きとなる傾向があり、その結果、基板が厚い場合であっても、基板及び積層部を容易に切断することが可能になるからである。ここで、距離とは、特に断りがない限り、基板の厚さ方向に沿っての距離を意味する（以下、同じ）。

【0014】

また、上記レーザー加工方法においては、第1の改質領域を形成する際にレーザー光の集光点を合わせる位置の裏面からの距離は $50\mu\text{m}\sim \left[(\text{基板の厚さ}) \times 0.9 \right] \mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件で第1の改質領域を形成すると、基板が厚い場合であっても、基板及び積層部を容易に切断することが可能になるからである。

【0015】

また、上記レーザー加工方法においては、第2の改質領域を形成する際にレーザー光の集光点を合わせる位置の裏面からの距離は $20\mu\text{m}\sim 110\mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件で第2の改質領域を形成すると、第2の改質領域を起点とした割れが基板の裏面に確実に達する傾向があるからである。なお、裏面からの距離が $20\mu\text{m}$ 未満になると、基板の裏面に溶融等の損傷が生じ易くなる。一方、裏面からの距離が $110\mu\text{m}$ を超えると、第2の改質領域を起点とした割れが基板の裏面に達し難くなる。

【0016】

また、上記レーザー加工方法においては、基板及び積層部を切断予定ラインに沿って切断する工程を更に含んでもよい。上述した理由から、複数の機能素子を含む積層部が形成された基板が厚い場合であっても、基板及び積層部を切断予定ラインに沿って精度良く切断することができる。

【0017】

更に、本発明に係る半導体チップは、基板と、機能素子を含んで基板の表面に形成された積層部とを備える半導体チップであって、基板の側面には、基板の厚さ方向において一続きとなるように、裏面に沿った第1の改質領域が複数列形成されており、側面において、裏面に最も近い第1の改質領域と裏面との間の位置には、裏面に沿った第2の改質領域が少なくとも1列形成されていることを特徴とする。

【0018】

この半導体チップは、上記レーザー加工方法の使用により切断されたものといえるため、第1の改質領域及び第2の改質領域が形成された基板の側面は、凹凸が抑制された高精度な切断面となっている。

【0019】

また、上記半導体チップにおいては、基板は半導体基板であり、第1の改質領域及び第2の改質領域は溶融処理領域を含む場合がある。基板が半導体基板であると、第1の改質領域及び第2の改質領域として、溶融処理領域を含む改質領域が形成される場合がある。

【0020】

また、上記半導体チップにおいては、対向する第1の改質領域の裏面側端部と第2の改質領域の表面側端部との距離は $15\mu\text{m}\sim 60\mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件で第1の改質領域及び第2の改質領域が形成されていると、基板及び積層部の切断時において、各改質領域を起点とした割れが切断予定ラインに沿って精度良く発生する傾向があり、半導体チップの基板の側面が高精度な切断面になるからである。なお、対向する第1の改質領域の裏面側端部と第2の改質領域の表面側端部との距離が $15\mu\text{m}$ 未満になると、基板及び積層部の切断時において各改質領域を起点とした割れが切断予定ラインから外れ易くなり、半導体チップの基板の側面が高精度な切断面になり難くなる。一方、対向する第1の改質領域の裏面側端部と第2の改質領域の表面側端部との距離が $60\mu\text{m}$ を超えると、基板及び積層部の切断時において第1の改質領域と第2の改質領域との相互作用が小さくなり、半導体チップの基板の側面が高精度な切断面になり難くなる。

【0021】

また、上記半導体チップにおいては、基板の厚さ方向における第1の改質領域の幅の合計は $40\mu\text{m}\sim [(\text{基板の厚さ})\times 0.9]\mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件で第1の改質領域が形成されていると、基板及び積層部の切断時において、第1の改質領域を起点とした割れが切断予定ラインに沿って精度良く発生する傾向があり、半導体チップの基板の側面が高精度な切断面になるからである。なお、第1の改質領域の幅の合計が $40\mu\text{m}$ 未満になると、基板及び積層部の切断時において第1の改質領域を起点とした割れが発生し難くなり、半導体チップの基板の側面が高精度な切断面になり難くなる。一方、第1の改質領域の幅の合計が $[(\text{基板の厚さ})\times 0.9]\mu\text{m}$ を超えると、基板及び積層部の切断時において第1の改質領域を起点とした割れが切断予定ラインから外れ易くなり、半導体チップの基板の側面が高精度な切断面になり難くなる。

【発明の効果】

【0022】

本発明は、複数の機能素子を含む積層部が形成された基板が厚い場合であっても、基板及び積層部の高精度な切断を可能にする。

【発明を実施するための最良の形態】

【0023】

以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施形態のレーザ加工方法では、加工対象物の内部に改質領域を形成するために多光子吸収という現象を利用する。そこで、最初に、多光子吸収により改質領域を形成するためのレーザ加工方法について説明する。

【0024】

材料の吸収のバンドギャップ E_G よりも光子のエネルギー $h\nu$ が小さいと光学的に透明となる。よって、材料に吸収が生じる条件は $h\nu > E_G$ である。しかし、光学的に透明でも、レーザ光の強度を非常に大きくすると $n h\nu > E_G$ の条件 ($n = 2, 3, 4, \dots$) で材料に吸収が生じる。この現象を多光子吸収という。パルス波の場合、レーザ光の強度はレーザ光の集光点のピークパワー密度 (W/cm^2) で決まり、例えばピークパワー密度が 1×10^8 (W/cm^2) 以上の条件で多光子吸収が生じる。ピークパワー密度は、(集光点におけるレーザ光の1パルス当たりのエネルギー) \div (レーザ光のビームスポット断面積 \times パルス幅) により求められる。また、連続波の場合、レーザ光の強度はレーザ光の集光点の電界強度 (W/cm^2) で決まる。

【0025】

このような多光子吸収を利用する本実施形態に係るレーザ加工方法の原理について、図1～図6を参照して説明する。図1に示すように、ウェハ状(平板状)の加工対象物1の表面3には、加工対象物1を切断するための切断予定ライン5がある。切断予定ライン5は直線状に延びた仮想線である。本実施形態に係るレーザ加工方法では、図2に示すように、多光子吸収が生じる条件で加工対象物1の内部に集光点Pを合わせてレーザ光Lを照射して改質領域7を形成する。なお、集光点Pとは、レーザ光Lが集光する箇所のことである。また、切断予定ライン5は、直線状に限らず曲線状であってもよいし、仮想線に限らず加工対象物1に実際に引かれた線であってもよい。

【0026】

そして、レーザ光Lを切断予定ライン5に沿って(すなわち、図1の矢印A方向に)相対的に移動させることにより、集光点Pを切断予定ライン5に沿って移動させる。これにより、図3～図5に示すように、改質領域7が切断予定ライン5に沿って加工対象物1の内部に形成され、この改質領域7が切断起点領域8となる。ここで、切断起点領域8とは、加工対象物1が切断される際に切断(割れ)の起点となる領域を意味する。この切断起点領域8は、改質領域7が連続的に形成されることで形成される場合もあるし、改質領域7が断続的に形成されることで形成される場合もある。

【0027】

本実施形態に係るレーザ加工方法は、加工対象物1がレーザ光Lを吸収することにより加工対象物1を発熱させて改質領域7を形成するものではない。加工対象物1にレーザ光Lを透過させ加工対象物1の内部に多光子吸収を発生させて改質領域7を形成している。よって、加工対象物1の表面3ではレーザ光Lがほとんど吸収されないので、加工対象物1の表面3が溶融することはない。

【0028】

加工対象物1の内部に切断起点領域8を形成すると、この切断起点領域8を起点として割れが発生し易くなるため、図6に示すように、比較的小さな力で加工対象物1を切断することができる。よって、加工対象物1の表面3に不必要な割れを発生させることなく、加工対象物1を高精度に切断することが可能になる。

【0029】

この切断起点領域8を起点とした加工対象物1の切断には、次の2通りが考えられる。1つは、切断起点領域8形成後、加工対象物1に人為的な力が印加されることにより、切断起点領域8を起点として加工対象物1が割れ、加工対象物1が切断される場合である。

これは、例えば加工対象物 1 の厚さが大きい場合の切断である。人為的な力が印加されるとは、例えば、加工対象物 1 の切断起点領域 8 に沿って加工対象物 1 に曲げ応力やせん断応力を加えたり、加工対象物 1 に温度差を与えることにより熱応力を発生させたりすることである。他の 1 つは、切断起点領域 8 を形成することにより、切断起点領域 8 を起点として加工対象物 1 の断面方向（厚さ方向）に向かって自然に割れ、結果的に加工対象物 1 が切断される場合である。これは、例えば加工対象物 1 の厚さが小さい場合には、1 列の改質領域 7 により切断起点領域 8 が形成されることで可能となり、加工対象物 1 の厚さが大きい場合には、厚さ方向に複数列形成された改質領域 7 により切断起点領域 8 が形成されることで可能となる。なお、この自然に割れる場合も、切断する箇所において、切断起点領域 8 が形成されていない部位に対応する部分の表面 3 上にまで割れが先走ることがなく、切断起点領域 8 を形成した部位に対応する部分のみを割断することができるので、割断を制御よくすることができる。近年、シリコンウェハ等の加工対象物 1 の厚さは薄くなる傾向にあるので、このような制御性のよい割断方法は大変有効である。

【0030】

さて、本実施形態に係るレーザ加工方法において、多光子吸収により形成される改質領域としては、次の（1）～（3）の場合がある。

【0031】

（1）改質領域が 1 つ又は複数のクラックを含むクラック領域の場合

加工対象物（例えばガラスや LiTaO_3 からなる圧電材料）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が 1×10^8 (W/cm^2) 以上で且つパルス幅が $1 \mu\text{s}$ 以下の条件でレーザ光を照射する。このパルス幅の大きさは、多光子吸収を生じさせつつ加工対象物の表面に余計なダメージを与えずに、加工対象物の内部にのみクラック領域を形成できる条件である。これにより、加工対象物の内部には多光子吸収による光学的損傷という現象が発生する。この光学的損傷により加工対象物の内部に熱ひずみが誘起され、これにより加工対象物の内部にクラック領域が形成される。電界強度の上限値としては、例えば 1×10^{12} (W/cm^2) である。パルス幅は例えば $1 \text{ ns} \sim 200 \text{ ns}$ が好ましい。なお、多光子吸収によるクラック領域の形成は、例えば、第 45 回レーザ熱加工研究会論文集（1998 年、12 月）の第 23 頁～第 28 頁の「固体レーザ高調波によるガラス基板の内部マーキング」に記載されている。

【0032】

本発明者は、電界強度とクラックの大きさとの関係を実験により求めた。実験条件は下記の通りである。

【0033】

（A）加工対象物：パイレックス（登録商標）ガラス（厚さ $700 \mu\text{m}$ ）

（B）レーザ

光源：半導体レーザ励起 Nd：YAG レーザ

波長： 1064 nm

レーザ光スポット断面積： $3.14 \times 10^{-8} \text{ cm}^2$

発振形態：Q スイッチパルス

繰り返し周波数： 100 kHz

パルス幅： 30 ns

出力：出力 $< 1 \text{ mJ}$ / パルス

レーザ光品質： TEM_{00}

偏光特性：直線偏光

（C）集光用レンズ

レーザ光波長に対する透過率： 60 パーセント

（D）加工対象物が載置される載置台の移動速度： $100 \text{ mm}/\text{秒}$

【0034】

なお、レーザ光品質が TEM_{00} とは、集光性が高くレーザ光の波長程度まで集光可能を意味する。

【0035】

図7は上記実験の結果を示すグラフである。横軸はピークパワー密度であり、レーザ光がパルスレーザ光なので電界強度はピークパワー密度で表される。縦軸は1パルスのレーザ光により加工対象物の内部に形成されたクラック部分（クラックスポット）の大きさを示している。クラックスポットが集まりクラック領域となる。クラックスポットの大きさは、クラックスポットの形状のうち最大の長さとなる部分の大きさである。グラフ中の黒丸で示すデータは集光用レンズ（C）の倍率が100倍、開口数（NA）が0.80の場合である。一方、グラフ中の白丸で示すデータは集光用レンズ（C）の倍率が50倍、開口数（NA）が0.55の場合である。ピークパワー密度が 10^{11} （W/cm²）程度から加工対象物の内部にクラックスポットが発生し、ピークパワー密度が大きくなるに従いクラックスポットも大きくなることから分かる。

【0036】

次に、クラック領域形成による加工対象物の切断のメカニズムについて、図8～図11を参照して説明する。図8に示すように、多光子吸収が生じる条件で加工対象物1の内部に集光点Pを合わせてレーザ光Lを照射して切断予定ラインに沿って内部にクラック領域9を形成する。クラック領域9は1つ又は複数のクラックを含む領域である。このように形成されたクラック領域9が切断起点領域となる。図9に示すように、クラック領域9を起点として（すなわち、切断起点領域を起点として）クラックがさらに成長し、図10に示すように、クラックが加工対象物1の表面3と裏面21とに到達し、図11に示すように、加工対象物1が割れることにより加工対象物1が切断される。加工対象物1の表面3と裏面21とに到達するクラックは自然に成長する場合もあるし、加工対象物1に力が印加されることにより成長する場合もある。

【0037】

（2）改質領域が熔融処理領域の場合

加工対象物（例えばシリコンのような半導体材料）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が 1×10^8 （W/cm²）以上で且つパルス幅が1μs以下の条件でレーザ光を照射する。これにより加工対象物の内部は多光子吸収によって局所的に加熱される。この加熱により加工対象物の内部に熔融処理領域が形成される。熔融処理領域とは一旦熔融後再固化した領域や、まさに熔融状態の領域や、熔融状態から再固化する状態の領域であり、相変化した領域や結晶構造が変化した領域ということもできる。また、熔融処理領域とは単結晶構造、非晶質構造、多結晶構造において、ある構造が別の構造に変化した領域ということもできる。つまり、例えば、単結晶構造から非晶質構造に変化した領域、単結晶構造から多結晶構造に変化した領域、単結晶構造から非晶質構造及び多結晶構造を含む構造に変化した領域を意味する。加工対象物がシリコン単結晶構造の場合、熔融処理領域は例えば非晶質シリコン構造である。電界強度の上限値としては、例えば 1×10^{12} （W/cm²）である。パルス幅は例えば1ns～200nsが好ましい。

【0038】

本発明者は、シリコンウェハの内部で熔融処理領域が形成されることを実験により確認した。実験条件は次の通りである。

【0039】

（A）加工対象物：シリコンウェハ（厚さ350μm、外径4インチ）

（B）レーザ

光源：半導体レーザ励起Nd：YAGレーザ

波長：1064nm

レーザ光スポット断面積： 3.14×10^{-8} cm²

発振形態：Qスイッチパルス

繰り返し周波数：100kHz

パルス幅：30ns

出力：20μJ／パルス

レーザ光品質：TEM₀₀

偏光特性：直線偏光

(C) 集光用レンズ

倍率：50倍

N.A.：0.55

レーザー光波長に対する透過率：60パーセント

(D) 加工対象物が載置される載置台の移動速度：100mm/秒

【0040】

図12は、上記条件でのレーザー加工により切断されたシリコンウェハの一部における断面の写真を表した図である。シリコンウェハ11の内部に熔融処理領域13が形成されている。なお、上記条件により形成された熔融処理領域13の厚さ方向の大きさは100 μ m程度である。

【0041】

熔融処理領域13が多光子吸収により形成されたことを説明する。図13は、レーザー光の波長とシリコン基板の内部の透過率との関係を示すグラフである。ただし、シリコン基板の表面側と裏面側それぞれの反射成分を除去し、内部のみの透過率を示している。シリコン基板の厚さtが50 μ m、100 μ m、200 μ m、500 μ m、1000 μ mの各々について上記関係を示した。

【0042】

例えば、Nd:YAGレーザーの波長である1064nmにおいて、シリコン基板の厚さが500 μ m以下の場合、シリコン基板の内部ではレーザー光が80%以上透過することが分かる。図12に示すシリコンウェハ11の厚さは350 μ mであるので、多光子吸収による熔融処理領域13はシリコンウェハ11の中心付近、つまり表面から175 μ mの部分に形成される。この場合の透過率は、厚さ200 μ mのシリコンウェハを参考にすると、90%以上なので、レーザー光がシリコンウェハ11の内部で吸収されるのは僅かであり、ほとんどが透過する。このことは、シリコンウェハ11の内部でレーザー光が吸収されて、熔融処理領域13がシリコンウェハ11の内部に形成（つまりレーザー光による通常の加熱で熔融処理領域が形成）されたものではなく、熔融処理領域13が多光子吸収により形成されたことを意味する。多光子吸収による熔融処理領域の形成は、例えば、溶接学会全国大会講演概要第66集（2000年4月）の第72頁～第73頁の「ピコ秒パルスレーザーによるシリコンの加工特性評価」に記載されている。

【0043】

なお、シリコンウェハは、熔融処理領域によって形成される切断起点領域を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割れがシリコンウェハの表面と裏面とに到達することにより、結果的に切断される。シリコンウェハの表面と裏面に到達するこの割れは自然に成長する場合もあるし、シリコンウェハに力が印加されることにより成長する場合もある。そして、切断起点領域からシリコンウェハの表面と裏面とに割れが自然に成長する場合には、切断起点領域を形成する熔融処理領域が熔融している状態から割れが成長する場合と、切断起点領域を形成する熔融処理領域が熔融している状態から再固化する際に割れが成長する場合とのいずれもある。ただし、どちらの場合も熔融処理領域はシリコンウェハの内部のみに形成され、切断後の切断面には、図12のように内部にのみ熔融処理領域が形成されている。このように、加工対象物の内部に熔融処理領域によって切断起点領域を形成すると、切断時、切断起点領域ラインから外れた不必要な割れが生じにくいので、切断制御が容易となる。

【0044】

(3) 改質領域が屈折率変化領域の場合

加工対象物（例えばガラス）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が 1×10^8 (W/cm²)以上で且つパルス幅が1ns以下の条件でレーザー光を照射する。パルス幅を極めて短くして、多光子吸収を加工対象物の内部に起こさせると、多光子吸収によるエネルギーが熱エネルギーに転化せずに、加工対象物の内部にはイオン価数変化、結晶化又は分極配向等の永続的な構造変化が誘起されて屈折率変化領域が形成される。電

界強度の上限値としては、例えば 1×10^{12} (W/cm^2) である。パルス幅は例えば 1 ns 以下が好ましく、 1 ps 以下がさらに好ましい。多光子吸収による屈折率変化領域の形成は、例えば、第42回レーザー熱加工研究会論文集(1997年・11月)の第105頁～第111頁の「フェムト秒レーザー照射によるガラス内部への光誘起構造形成」に記載されている。

【0045】

以上、多光子吸収により形成される改質領域として(1)～(3)の場合を説明したが、ウェハ状の加工対象物の結晶構造やその劈開性を考慮して切断起点領域を次のように形成すれば、その切断起点領域を起点として、より一層小さな力で、しかも精度良く加工対象物を切断することが可能になる。

【0046】

すなわち、シリコンなどのダイヤモンド構造の単結晶半導体からなる基板の場合は、(111)面(第1劈開面)や(110)面(第2劈開面)に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。また、GaAsなどの閃亜鉛鉱型構造のIII-V族化合物半導体からなる基板の場合は、(110)面に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。さらに、サファイア(Al_2O_3)などの六方晶系の結晶構造を有する基板の場合は、(0001)面(C面)を主面として(1120)面(A面)或いは(1100)面(M面)に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。

【0047】

なお、上述した切断起点領域を形成すべき方向(例えば、単結晶シリコン基板における(111)面に沿った方向)、或いは切断起点領域を形成すべき方向に直交する方向に沿って基板にオリエンテーションフラットを形成すれば、そのオリエンテーションフラットを基準とすることで、切断起点領域を形成すべき方向に沿った切断起点領域を容易且つ正確に基板に形成することが可能になる。

【0048】

次に、本発明の好適な実施形態について説明する。図14は、本実施形態のレーザー加工方法における加工対象物の平面図であり、図15は、図14に示す加工対象物のXV-XV線に沿っての部分断面図である。

【0049】

図14及び図15に示すように、加工対象物1は、シリコンからなる厚さ $300 \mu\text{m}$ の基板4と、複数の機能素子15を含んで基板4の表面3に形成された積層部16とを備えている。機能素子15は、基板4の表面3に積層された層間絶縁膜17aと、層間絶縁膜17a上に配置された配線層19aと、配線層19aを覆うように層間絶縁膜17a上に積層された層間絶縁膜17bと、層間絶縁膜17b上に配置された配線層19bとを有している。配線層19aと基板4とは、層間絶縁膜17aを貫通する導電性プラグ20aによって電氣的に接続され、配線層19bと配線層19aとは、層間絶縁膜17bを貫通する導電性プラグ20bによって電氣的に接続されている。

【0050】

なお、機能素子15は、基板4のオリエンテーションフラット6に平行な方向及び垂直な方向にマトリックス状に多数形成されているが、層間絶縁膜17a、17bは、基板4の表面3全体を覆うように隣り合う機能素子15、15間に渡って形成されている。

【0051】

以上のように構成された加工対象物1を以下のようにして機能素子15毎に切断する。まず、図16(a)に示すように、積層部16を覆うように加工対象物1に保護テープ22を貼り付ける。続いて、図16(b)に示すように、基板4の裏面21を上方に向けて加工対象物1をレーザー加工装置の載置台(図示せず)上に固定する。このとき、積層部16が載置台に直接接触することが保護テープ22によって避けられるため、各機能素子15を保護することができる。

【0052】

そして、隣り合う機能素子15、15間を通るように切断予定ライン5を格子状に設定

し（図 1 4 の破線参照）、裏面 2 1 をレーザ光入射面として基板 4 の内部に集光点 P を合わせてレーザ光 L を多光子吸収が生じる条件で照射しながら、載置台の移動により切断予定ライン 5 に沿って集光点 P をスキャンする。

【 0 0 5 3 】

この切断予定ライン 5 に沿った集光点 P のスキャンを 1 本の切断予定ライン 5 に対して 6 回行うが、集光点 P を合わせる位置の裏面 2 1 からの距離を各回毎に変えることで、表面 3 側から順に、1 列の品質改質領域 7 1、3 列の分断改質領域（第 1 の改質領域）7 2、及び 2 列の HC（ハーフカット）改質領域（第 2 の改質領域）7 3 を切断予定ライン 5 に沿って基板 4 の内部に 1 列ずつ形成する（各改質領域 7 1、7 2、7 3 の形成条件等については後述する）。なお、基板 4 はシリコンからなる半導体基板であるため、各改質領域 7 1、7 2、7 3 は溶融処理領域である。

【 0 0 5 4 】

このように、各改質領域 7 1、7 2、7 3 を基板 4 の裏面 2 1 から遠い順に 1 列ずつ形成することで、各改質領域 7 1、7 2、7 3 を形成するに際し、レーザ光入射面である裏面 2 1 とレーザ光 L の集光点 P との間には改質領域が存在しないため、既に形成された改質領域によるレーザ光 L の散乱、吸収等が起こることはない。従って、各改質領域 7 1、7 2、7 3 を切断予定ライン 5 に沿って基板 4 の内部に精度良く形成することができる。また、基板 4 の裏面 2 1 をレーザ光入射面とすることで、積層部 1 6 の切断予定ライン 5 上にレーザ光 L を反射する部材（例えば、TEG）が存在しても、各改質領域 7 1、7 2、7 3 を切断予定ライン 5 に沿って基板 4 の内部に確実に形成することができる。

【 0 0 5 5 】

ここで、品質改質領域 7 1 の形成では、図 1 9 に示すように、基板 4 の表面 3 と品質改質領域 7 1 の表面側端部 7 1 a との距離が $5\ \mu\text{m} \sim 20\ \mu\text{m}$ となる位置に、或いは基板 4 の表面 3 と品質改質領域 7 1 の裏面側端部 7 1 b との距離が $[5 + (\text{基板 4 の厚さ}) \times 0.1]\ \mu\text{m} \sim [20 + (\text{基板 4 の厚さ}) \times 0.1]\ \mu\text{m}$ となる位置に品質改質領域 7 1 を 1 列形成する。また、分断改質領域 7 2 の形成では、基板 4 の厚さ方向において一続きとなるように分断改質領域 7 2 を 3 列形成する。更に、HC 改質領域 7 3 の形成では、図 1 6（b）に示すように、HC 改質領域 7 3 を 2 列形成することで、切断予定ライン 5 に沿った割れ 2 4 を HC 改質領域 7 3 から基板 4 の裏面 2 1 に生じさせる。なお、形成条件によっては、隣り合う分断改質領域 7 2 と HC 改質領域 7 3 との間にも割れ 2 4 が生じる場合がある。

【 0 0 5 6 】

各改質領域 7 1、7 2、7 3 を形成した後、図 1 7（a）に示すように、加工対象物 1 の基板 4 の裏面 2 1 にエキスパンドテープ 2 3 を貼り付ける。続いて、図 1 7（b）に示すように、保護テープ 2 2 に紫外線を照射して、その粘着力を低下させ、図 1 8（a）に示すように、加工対象物 1 の積層部 1 6 から保護テープ 2 2 を剥がす。

【 0 0 5 7 】

保護テープ 2 2 を剥がした後、図 1 8（b）に示すように、エキスパンドテープ 2 3 を拡張させて、各改質領域 7 1、7 2、7 3 を起点として割れを生じさせ、基板 4 及び積層部 1 6 を切断予定ライン 5 に沿って切断すると共に、切断されて得られた各半導体チップ 2 5 を互いに離間させる。

【 0 0 5 8 】

以上説明したように、上記レーザ加工方法においては、切断（割れ）の起点となる品質改質領域 7 1、分断改質領域 7 2 及び HC 改質領域 7 3 を切断予定ライン 5 に沿って基板 4 の内部に形成している。従って、上記レーザ加工方法は、複数の機能素子 1 5 を含む積層部 1 6 が形成された基板 4 の厚さが $300\ \mu\text{m}$ というように厚い場合であっても、基板 4 及び積層部 1 6 の高精度な切断を可能にする。

【 0 0 5 9 】

具体的には、上記レーザ加工方法においては、基板 4 の裏面 2 1 に最も近い分断改質領域 7 2 と裏面 2 1 との間の位置に、HC 改質領域 7 3 を 2 列形成することで、切断予定ラ

イン5に沿った割れ24をHC改質領域73から基板4の裏面21に生じさせている。これにより、エキスパンドテープ23を基板4の裏面21に貼り付けて拡張させると、厚さ方向において一続きとなるように3列形成された分断改質領域72を介して基板4から積層部16へとスムーズに割れが進行することとなり、その結果、基板4及び積層部16を切断予定ライン5に沿って精度良く切断することができる。

【0060】

なお、基板4から積層部16へとスムーズに割れを進行させることができれば、分断改質領域72は3列に限定されない。一般的には、基板4が薄くなれば分断改質領域72の列数を減少させ、基板4が厚くなれば分断改質領域72の列数を増加させることになる。また、基板4から積層部16へとスムーズに割れを進行させることができれば、分断改質領域72は互いに離間していてもよい。更に、HC改質領域73から基板4の裏面21に割れ24を確実に生じさせることができれば、HC改質領域73は1列であってもよい。

【0061】

また、上記レーザー加工方法においては、基板4の表面3と品質改質領域71の表面側端部71aとの距離が5μm～20μmとなる位置に、或いは基板4の表面3と品質改質領域71の裏面側端部71bとの距離が[5+(基板4の厚さ)×0.1]μm～[20+(基板4の厚さ)×0.1]μmとなる位置に品質改質領域71を形成している。このような位置に品質改質領域71を形成すると、基板4の表面3に形成された積層部16（ここでは、層間絶縁膜17a、17b）も切断予定ライン5に沿って精度良く切断することができる。

【0062】

以上のようなレーザー加工方法の使用により切断された半導体チップ25においては、図18（b）に示すように、各改質領域71、72、73が形成された基板4の切断面（側面）4a、及び積層部16の切断面（側面）16aは、凹凸が抑制された高精度な切断面となる。

【0063】

図20は、上記レーザー加工方法の使用により切断された基板4の切断面4aの写真を表した図である。上述したように、基板4はシリコンからなり、その厚さは300μmである。各改質領域71、72、73の形成条件は下記の表1の通りである。なお、表1において、集光点位置とは、レーザー光Lの集光点Pを合わせる位置の裏面21からの距離を意味し、エネルギーとは、各改質領域71、72、73を形成する際のレーザー光Lのエネルギーを意味する。また、各改質領域71、72、73を形成する際のレーザー光Lのパルス幅は150nsであり、切断予定ライン5に沿ってレーザー光Lが照射される際に1パルスのレーザー光Lが照射される位置（集光点Pが合わされる位置）の間隔（以下、レーザー光照射位置の間隔という）は4μmである。

【0064】

【表1】

	集光点位置(μm)	エネルギー(μJ)
品質改質領域71	267	15
分断改質領域72(表面3側)	196	20
分断改質領域72	160	20
分断改質領域72(裏面21側)	125	20
HC改質領域73(表面3側)	71	10
HC改質領域73(裏面21側)	39	10

【0065】

このとき、基板4の厚さ方向における品質改質領域71の幅は約20μm、各分断改質領域72の幅は約37μm、各HC改質領域73の幅は約20μmであった。また、表面3と品質改質領域71の表面側端部71aとの距離は約7μm、対向する品質改質領域71の裏面側端部71bと分断改質領域72の表面側端部72aとの距離は約59μm、対

向する分断改質領域 7 2 の裏面側端部 7 2 b と品質改質領域 7 3 の表面側端部 7 3 a との距離は約 2 4 μ m であった。更に、各分断改質領域 7 2 は、基板 4 の厚さ方向において一続きとなるように形成されていた。

【 0 0 6 6 】
ところで、品質改質領域 7 1 の幅とは、品質改質領域 7 1 の表面側端部 7 1 a と裏面側端部 7 1 b との距離を意味する（図 1 9 参照）。また、品質改質領域 7 1 の表面側端部 7 1 a とは、切断予定ライン 5 に沿って形成された品質改質領域 7 1 の表面 3 側の端部の「基板 4 の厚さ方向における平均的位置」を意味し、品質改質領域 7 1 の裏面側端部 7 1 b とは、切断予定ライン 5 に沿って形成された品質改質領域 7 1 の裏面 2 1 側の端部の「基板 4 の厚さ方向における平均的位置」を意味する。これらのことは、分断改質領域 7 2 及び H C 改質領域 7 3 についても同様である。

【 0 0 6 7 】
次に、上述した各改質領域 7 1 , 7 2 , 7 3 の形成条件等について説明する。なお、以下の形成条件等は、基板 4 の厚さが 1 5 0 μ m ~ 8 0 0 μ m の場合に特に有効である。

【 0 0 6 8 】
（ 1 ） H C 改質領域 7 3 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーについて
H C 改質領域 7 3 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーは、下記の表 2 のデータから明らかなように、 1 μ J ~ 2 0 μ J であることが好ましい。より詳細には、基板 4 におけるレーザ光 L の透過率が 3 0 % 以上の場合には 1 μ J ~ 1 0 μ J であることが好ましく、同透過率が 1 5 % 以下の場合には 2 μ J ~ 2 0 μ J であることが好ましい。なお、透過率は、基板 4 の厚さが厚く、不純物の濃度が高い場合に著しく低下する。

【 0 0 6 9 】
このような条件で H C 改質領域 7 3 を形成すると、H C 改質領域 7 3 を起点とした割れ 2 4 が基板 4 の裏面 2 1 に確実に達する傾向があるからである。なお、レーザ光 L のエネルギーが 1 μ J 未満になると、H C 改質領域 7 3 を起点とした割れ 2 4 が基板 4 の裏面 2 1 に達し難くなる。一方、レーザ光 L のエネルギーが 2 0 μ J を超えると、図 2 1 に示すように、基板 4 の裏面 2 1 に溶融等の損傷 3 0 が生じ易くなる。図 2 1 は、H C 改質領域 7 3 を形成する際にレーザ光 L の集光点 P を合わせる位置の裏面 2 1 からの距離を 4 0 μ m、レーザ光 L のエネルギーを 2 5 μ J とした場合における基板 4 の裏面 2 1 の写真を表した図である。

【 0 0 7 0 】

【表 2】

エネルギー(μ J)	0.5	1.0	2.0	2.5	5.0	10	15	20	25
透過率 30% 以上	△	○	○	○	○	○	×	×	×
透過率 15% 以下	×	△	○	○	○	○	○	○	×

低エネルギー側の「△」: 割れ 24 が基板 4 の裏面 21 に達する部分と
達しない部分とが混在する場合
低エネルギー側の「×」: 割れ 24 が基板 4 の裏面 21 に殆ど達しない場合
高エネルギー側の「×」: 基板 4 の裏面 21 に溶融等の損傷が生じる場合

【 0 0 7 1 】
なお、表 2 のデータは、H C 改質領域 7 3 を基板 4 の裏面 2 1 から 2 0 μ m ~ 1 1 0 μ m の範囲内に 1 列以上形成した場合のものである。

【 0 0 7 2 】
（ 2 ） 分断改質領域 7 2 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーについて
分断改質領域 7 2 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーは、下記の表 3 のデータから明らかなように、H C 改質領域 7 3 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーを 1 とした場合、 1 . 6 ~ 3 . 0 であることが好ましい。より詳細には、基板 4 におけるレーザ光 L の透過率が 3 0 % 以上の場合には 1 . 6 ~ 3 . 0 であることが好ましく、同透過率が 1 5 % 以下の場合には 2 . 3 ~ 3 . 0 であることが好ましい。

【 0 0 7 3 】

このような条件で分断改質領域 7 2 を形成すると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、分断改質領域 7 2 を起点とした割れが切断予定ライン 5 に沿って精度良く発生する傾向があるからである。なお、レーザ光 L のエネルギーが 1 . 6 未満になると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、分断改質領域 7 2 を起点とした割れが発生し難くなる。一方、レーザ光 L のエネルギーが 3 . 0 を超えると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、分断改質領域 7 2 を起点とした割れが切断予定ライン 5 から外れ易くなる。

【 0 0 7 4 】

【表 3】

エネルギー比	1. 0	1. 1	1. 3	1. 4	1. 5	1. 6	1. 7	1. 8
透過率 30 % 以上	×	×	×	×	△	○	○	○
透過率 15 % 以下	×	×	×	×	×	×	×	×
エネルギー比	1. 9	2. 0	2. 1	2. 2	2. 3	3. 0	3. 1	3. 2
透過率 30 % 以上	○	○	○	○	○	○	△	×
透過率 15 % 以下	×	×	△	△	○	○	△	×

低エネルギー側の「△」: 切断品質の良い部分と悪い部分とが混在する場合
低エネルギー側の「×」: 過大な応力を印加しないと割れが発生せず、
切断品質が悪い場合
高エネルギー側の「△」: 切断品質の良い部分と悪い部分とが混在する場合
高エネルギー側の「×」: 切断面に欠けが生じる等、切断品質が悪い場合

【 0 0 7 5 】

また、分断改質領域 7 2 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーは、下記の表 4 のデータから明らかなように、2 μ J ～ 5 0 μ J であることが好ましい。より詳細には、基板 4 におけるレーザ光 L の透過率が 3 0 % 以上の場合には 2 μ J ～ 2 0 μ J であることが好ましく（より好ましくは、2 μ J ～ 1 5 μ J）、同透過率が 1 5 % 以下の場合には 3 μ J ～ 5 0 μ J であることが好ましい（より好ましくは、3 μ J ～ 4 5 μ J）。透過率が 1 5 % 以下の場合、レーザ光 L のエネルギーの好適な範囲が広がっているが、これは、透過率が低くなればなるほど、改質領域を形成するためにより大きなエネルギーが必要となるからである。

【 0 0 7 6 】

このような条件で分断改質領域 7 2 を形成すると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、分断改質領域 7 2 を起点とした割れが切断予定ライン 5 に沿って精度良く発生する傾向があるからである。なお、レーザ光 L のエネルギーが 2 μ J 未満になると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、分断改質領域 7 2 を起点とした割れが発生し難くなる。一方、レーザ光 L のエネルギーが 5 0 μ J を超えると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、分断改質領域 7 2 を起点とした割れが切断予定ライン 5 から外れ易くなる。

【 0 0 7 7 】

【表 4】

エネルギー (μ J)	1. 0	2. 0	3. 0	5. 0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
透過率 30 % 以上	×	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×
透過率 15 % 以下	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×

低エネルギー側の「△」: 切断品質の良い部分と悪い部分とが混在する場合
低エネルギー側の「×」: 過大な応力を印加しないと割れが発生せず、
切断品質が悪い場合
高エネルギー側の「△」: 切断品質の良い部分と悪い部分とが混在する場合
高エネルギー側の「×」: 切断面に欠けが生じる等、切断品質が悪い場合

【 0 0 7 8 】

(3) 品質改質領域 7 1 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーについて
品質改質領域 7 1 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーは、下記の表 5 のデータから

明らかなように、H C 改質領域 7 3 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーを 1 とした場合において、基板 4 におけるレーザ光 L の透過率が 3 0 % 以上のときには 1 . 4 ~ 1 . 9 であることが好ましく、同透過率が 1 5 % 以下のときには 2 . 3 ~ 3 . 0 であることが好ましい。

【 0 0 7 9 】

このような条件で品質改質領域 7 1 を形成すると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、品質改質領域 7 1 を起点とした割れが切断予定ライン 5 に沿って精度良く積層部 1 6 に達する傾向があるからである。なお、レーザ光 L のエネルギーが上記条件を下回ると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、品質改質領域 7 1 を起点とした割れが切断予定ライン 5 から外れて積層部 1 6 に達し易くなる。一方、レーザ光 L のエネルギーが上記条件を上回ると、積層部 1 6 に溶融等の損傷が生じ易くなる。

【 0 0 8 0 】

【表 5】

エネルギー比	1. 0	1. 1	1. 3	1. 4	1. 5	1. 6	1. 7	1. 8
透 過 率 30%以上	×	×	△	○	○	○	○	○
透 過 率 15%以下	×	×	×	×	×	×	×	×
エネルギー比	1. 9	2. 0	2. 1	2. 2	2. 3	3. 0	3. 1	3. 2
透 過 率 30%以上	○	△	×	×	×	×	×	×
透 過 率 15%以下	×	×	△	△	○	○	△	×

低エネルギー側の「△」: 切断品質の良い部分と悪い部分とが混在する場合
低エネルギー側の「×」: 過大な応力を印加しないと割れが発生せず、
切断品質が悪い場合
高エネルギー側の「△」: 積層部 16 に部分的に溶融等の損傷が生じる場合
高エネルギー側の「×」: 積層部 16 に溶融等の損傷が生じる場合

【 0 0 8 1 】

また、品質改質領域 7 1 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーは、下記の表 6 のデータから明らかなように、2 μ J ~ 5 0 μ J であることが好ましい。より詳細には、基板 4 におけるレーザ光 L の透過率が 3 0 % 以上の場合には 2 μ J ~ 2 0 μ J であることが好ましく（より好ましくは、2 μ J ~ 1 5 μ J ）、同透過率が 1 5 % 以下の場合には 3 μ J ~ 5 0 μ J であることが好ましい（より好ましくは、3 μ J ~ 4 5 μ J ）。

【 0 0 8 2 】

このような条件で品質改質領域 7 1 を形成すると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、品質改質領域 7 1 を起点とした割れが切断予定ライン 5 に沿って精度良く積層部 1 6 に達する傾向があるからである。なお、レーザ光 L のエネルギーが 2 μ J 未満になると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、品質改質領域 7 1 を起点とした割れが切断予定ライン 5 から外れて積層部 1 6 に達し易くなる。一方、レーザ光 L のエネルギーが 5 0 μ J を超えると、積層部 1 6 に溶融等の損傷が生じ易くなる。

【 0 0 8 3 】

【表 6】

エネルギー (μ J)	1. 0	2. 0	3. 0	5. 0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
透 過 率 30%以上	×	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×
透 過 率 15%以下	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×

低エネルギー側の「△」: 切断品質の良い部分と悪い部分とが混在する場合
低エネルギー側の「×」: 過大な応力を印加しないと割れが発生せず、
切断品質が悪い場合
高エネルギー側の「△」: 積層部 16 に部分的に溶融等の損傷が生じる場合
高エネルギー側の「×」: 積層部 16 に溶融等の損傷が生じる場合

【 0 0 8 4 】

(4) 分断改質領域72の形成位置について

隣り合う分断改質領域72のそれぞれを形成する際にレーザ光Lの集光点Pを合わせる位置間の距離は $24\mu\text{m} \sim 70\mu\text{m}$ であることが好ましい。より詳細には、基板4におけるレーザ光Lの透過率が30%以上の場合には $30\mu\text{m} \sim 70\mu\text{m}$ であることが好ましく、同透過率が15%以下の場合には $24\mu\text{m} \sim 50\mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件で分断改質領域72を形成すると、隣り合う分断改質領域72、72同士が基板4の厚さ方向において一続きとなる傾向があり、その結果、基板4が厚い場合であっても、基板4及び積層部16を容易に切断することが可能になるからである。

【0085】

また、分断改質領域72を形成する際にレーザ光Lの集光点Pを合わせる位置の裏面21からの距離は $50\mu\text{m} \sim [(\text{基板4の厚さ}) \times 0.9 (\text{好ましくは} 0.7)]\mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件で分断改質領域72を形成すると、基板4が厚い場合であっても、基板4及び積層部16を容易に切断することが可能になるからである。

【0086】

なお、隣り合う分断改質領域72及びHC改質領域73を形成する場合、分断改質領域72を形成する際にレーザ光Lの集光点Pを合わせる位置は、HC改質領域73を形成する際にレーザ光Lの集光点Pを合わせる位置から基板4の表面3側に $30\mu\text{m} \sim 100\mu\text{m}$ の範囲内にあることが好ましい。このとき、対向する分断改質領域72の裏面側端部とHC改質領域73の表面側端部との距離は $15\mu\text{m} \sim 60\mu\text{m}$ （好ましくは、 $15\mu\text{m} \sim 35\mu\text{m}$ ）となり、隣り合う分断改質領域72とHC改質領域73との間にも割れ24が生じ易くなるからである。

【0087】

(5) HC改質領域73の形成位置について

HC改質領域73を形成する際にレーザ光Lの集光点Pを合わせる位置の裏面21からの距離は $20\mu\text{m} \sim 110\mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件でHC改質領域73を形成すると、HC改質領域73を起点とした割れ24が基板4の裏面21に確実に達する傾向があるからである。なお、裏面21からの距離が $20\mu\text{m}$ 未満になると、図22に示すように、基板4の裏面21に溶融等の損傷30が生じ易くなる。図22は、HC改質領域73を形成する際にレーザ光Lの集光点Pを合わせる位置の裏面21からの距離を $15\mu\text{m}$ 、レーザ光Lのエネルギーを $10\mu\text{J}$ とした場合における基板4の裏面21の写真を表した図である。一方、裏面21からの距離が $110\mu\text{m}$ を超えると、HC改質領域73を起点とした割れ24が基板4の裏面21に達し難くなる。なお、このとき、基板4の裏面21とHC改質領域73の裏面側端部との距離は $10\mu\text{m} \sim 100\mu\text{m}$ となる。

【0088】

(6) 対向する分断改質領域72の裏面側端部とHC改質領域73の表面側端部との距離について

対向する分断改質領域72の裏面側端部とHC改質領域73の表面側端部との距離は $15\mu\text{m} \sim 60\mu\text{m}$ であることが好ましく、 $15\mu\text{m} \sim 35\mu\text{m}$ であることがより好ましい。このような条件で分断改質領域72及びHC改質領域73を形成すると、基板4及び積層部26の切断時において、各改質領域72、73を起点とした割れが切断予定ライン5に沿って精度良く発生する傾向があり、半導体チップ25の基板4の切断面4aが高精度な切断面になるからである。なお、当該距離が $15\mu\text{m}$ 未満になると、基板4及び積層部16の切断時において各改質領域72、73を起点とした割れが切断予定ライン5から外れ易くなり、半導体チップ25の基板4の切断面4aが高精度な切断面になり難くなる。一方、当該距離が $60\mu\text{m}$ を超えると、基板4及び積層部16の切断時において分断改質領域72とHC改質領域73との相互作用が小さくなり、半導体チップ25の基板4の切断面4aが高精度な切断面になり難くなる。

【0089】

(7) 対向する品質改質領域71の裏面側端部と分断改質領域72の表面側端部との距離について

対向する品質改質領域 7 1 の裏面側端部と分断改質領域 7 2 の表面側端部との距離は $0\ \mu\text{m} \sim [(\text{基板 } 4 \text{ の厚さ}) - (\text{基板 } 4 \text{ の厚さ}) \times 0.6]\ \mu\text{m}$ であることが好ましい。このような条件で品質改質領域 7 1 及び分断改質領域 7 2 を形成すると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、各改質領域 7 1, 7 2 を起点とした割れが切断予定ライン 5 に沿って精度良く発生する傾向があり、半導体チップ 2 5 の基板 4 の切断面 4 a 及び積層部 1 6 の切断面 1 6 a が高精度な切断面になるからである。なお、当該距離が $[(\text{基板 } 4 \text{ の厚さ}) - (\text{基板 } 4 \text{ の厚さ}) \times 0.6]\ \mu\text{m}$ を超えると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において品質改質領域 7 1 と分断改質領域 7 2 と間で半導体チップ 2 5 の基板 4 の切断面 4 a が高精度な切断面になり難くなる。また、当該距離を $0\ \mu\text{m}$ とするのは、レーザ光 L の照射のみにより基板 4 を完全に切断するような場合である。

【0090】

(8) 品質改質領域 7 1 の形成位置について

基板 4 の表面 3 と品質改質領域 7 1 の表面側端部との距離が $5\ \mu\text{m} \sim 20\ \mu\text{m}$ となる位置に、或いは基板 4 の表面 3 と品質改質領域 7 1 の裏面側端部との距離が $[5 + (\text{基板 } 4 \text{ の厚さ}) \times 0.1]\ \mu\text{m} \sim [20 + (\text{基板 } 4 \text{ の厚さ}) \times 0.1]\ \mu\text{m}$ となる位置に品質改質領域 7 1 を形成することが好ましい。このような条件で品質改質領域 7 1 を形成すると、図 2 3 に示すように、スカート幅 S を $5\ \mu\text{m}$ 以下に抑えることができ、基板 4 の表面 3 に形成された積層部 1 6 も切断予定ライン 5 に沿って精度良く切断することが可能だからである。

【0091】

また、基板 4 の表面 3 と品質改質領域 7 1 の表面側端部との距離が $5\ \mu\text{m} \sim 10\ \mu\text{m}$ となる位置に、或いは基板 4 の表面 3 と品質改質領域 7 1 の裏面側端部との距離が $[5 + (\text{基板 } 4 \text{ の厚さ}) \times 0.1]\ \mu\text{m} \sim [10 + (\text{基板 } 4 \text{ の厚さ}) \times 0.1]\ \mu\text{m}$ となる位置に品質改質領域 7 1 を形成することがより好ましい。このような条件で品質改質領域 7 1 を形成すると、図 2 3 に示すように、スカート幅 S を $1\ \mu\text{m}$ 以下に抑えることができ、基板 4 の表面 3 側の端部及び積層部 1 6 を切断予定ライン 5 に沿ってより一層精度良く切断することが可能だからである。

【0092】

なお、図 2 3 において、集光点位置とは、レーザ光 L の集光点 P を合わせる位置の裏面 2 1 からの距離を意味し、エネルギーとは、品質改質領域 7 1 を形成する際のレーザ光 L のエネルギーを意味する。また、裏面側端部位置とは、品質改質領域 7 1 の裏面側端部の裏面 2 1 からの距離を意味し、幅とは、品質改質領域 7 1 の表面側端部と裏面側端部との距離を意味し、表面側端部位置とは、品質改質領域 7 1 の表面側端部の表面 3 からの距離を意味する。

【0093】

また、基板 4 の表面 3 と品質改質領域 7 1 の表面側端部との距離が $5\ \mu\text{m}$ 未満になると、図 2 4 に示すように、基板 4 の表面 3 に熔融等の損傷 3 0 が生じ易くなる。図 2 4 は、品質改質領域 7 1 を形成する際にレーザ光 L の集光点 P を合わせる位置の表面 3 からの距離を $3\ \mu\text{m}$ 、レーザ光 L のエネルギーを $15\ \mu\text{J}$ とした場合における基板 4 の切断面の写真を表した図である。

【0094】

(9) 各改質領域 7 1, 7 2, 7 3 の幅について

基板 4 の厚さ方向における HC 改質領域 7 3 の幅 (HC 改質領域 7 3 を複数列形成する場合には幅の合計) は $110\ \mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。このような条件で HC 改質領域 7 3 を形成すると、HC 改質領域 7 3 から基板 4 の裏面 2 1 に達する亀裂 2 4 が切断予定ライン 5 に沿って精度良く形成される傾向があるからである。なお、HC 改質領域 7 3 の幅が $110\ \mu\text{m}$ を超えると、HC 改質領域 7 3 から基板 4 の裏面 2 1 達する亀裂 2 4 が切断予定ライン 5 から外れ易くなる。

【0095】

また、基板 4 の厚さ方向における分断改質領域 7 2 の幅の合計は $40\ \mu\text{m} \sim [(\text{基板 } 4$

の厚さ) $\times 0.9$ μm であることが好ましい。このような条件で分断改質領域 7 2 を形成すると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、分断改質領域 7 2 を起点とした割れが切断予定ライン 5 に沿って精度良く発生する傾向があり、半導体チップ 2 5 の基板 4 の切断面 4 a が高精度な切断面になるからである。なお、分断改質領域 7 2 の幅の合計が 40 μm 未満であると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において分断改質領域 7 2 を起点とした割れが発生し難くなり、半導体チップ 2 5 の基板 4 の切断面 4 a が高精度な切断面になり難くなる。一方、分断改質領域 7 2 の幅の合計が $[(\text{基板 4 の厚さ}) \times 0.9] \mu\text{m}$ を超えると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において分断改質領域 7 2 を起点とした割れが切断予定ライン 5 から外れ易くなり、半導体チップ 2 5 の基板 4 の切断面 4 a が高精度な切断面になり難くなる。

【0096】

また、基板 4 の厚さ方向における品質改質領域 7 1 の幅は $[(\text{基板 4 の厚さ}) \times 0.1] \mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。このような条件で品質改質領域 7 1 を形成すると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、品質改質領域 7 1 を起点とした割れが切断予定ライン 5 に沿って精度良く積層部 1 6 に達する傾向があるからである。なお、品質改質領域 7 1 の幅が $[(\text{基板 4 の厚さ}) \times 0.1] \mu\text{m}$ を超えると、基板 4 及び積層部 1 6 の切断時において、品質改質領域 7 1 を起点とした割れが切断予定ライン 5 から外れて積層部 1 6 に達し易くなる。

【0097】

以上、各改質領域 7 1, 7 2, 7 3 の形成条件等について説明したが、各改質領域 7 1, 7 2, 7 3 を形成する際のレーザ光 L のパルス幅は 500 ns 以下が好ましく、10 ns \sim 300 ns がより好ましい（更に好ましくは、100 ns \sim 300 ns）。また、レーザ光照射位置の間隔は 0.1 $\mu\text{m} \sim$ 10 μm であることが好ましい。レーザ光照射位置の間隔は、レーザの繰り返し周波数とレーザ光の移動速度とから適宜設定することが可能である。

【0098】

また、分断改質領域 7 2 の形成において、上述した分断改質領域 7 2 についての各種形成条件を満たしていないと、図 25 (a) に示すように、加工対象物 1 が半導体チップ 2 5 に切断されない部分が生じてしまう。一方、上述した分断改質領域 7 2 についての各種形成条件を満たしていると、図 25 (b) に示すように、加工対象物 1 の全体が半導体チップ 2 5 に確実に切断される。

【0099】

本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態は、基板 4 の内部で多光子吸収を生じさせて各改質領域 7 1, 7 2, 7 3 を形成する場合であったが、基板 4 の内部で多光子吸収と同等の光吸収を生じさせて各改質領域 7 1, 7 2, 7 3 を形成することができる場合もある。

【0100】

また、上記実施形態は、積層部 1 6 側から順に、1 列の品質改質領域 7 1、3 列の分断改質領域 7 2、及び 2 列の HC 改質領域 7 3 を基板 4 の内部に形成する場合であったが、次のように各改質領域 7 1, 7 2, 7 3 を基板 4 の内部に形成してもよい。

【0101】

例えば、図 26 に示すように、基板 4 の表面 3 側から順に、1 列の品質改質領域 7 1、2 列の分断改質領域 7 2、及び 1 列の HC 改質領域 7 3 を基板 4 の内部に形成してもよい。ここで、基板 4 はシリコンからなり、その厚さは 200 μm である。各改質領域 7 1, 7 2, 7 3 の形成条件は下記の表 7 の通りである。なお、各改質領域 7 1, 7 2, 7 3 を形成する際のレーザ光 L のパルス幅は 150 ns であり、レーザ光照射位置の間隔は 4 μm である。

【0102】

【表 7】

	集光点位置 (μm)	エネルギー (μJ)
品質改質領域 71	167	15
分断改質領域 72 (表面 3 側)	121	20
分断改質領域 72 (裏面 21 側)	71	20
HC改質領域 73	39	10

【 0 1 0 3 】

また、図 2 7 に示すように、基板 4 の表面 3 側から順に、1 列の品質改質領域 7 1、2 列の分断改質領域 7 2、及び 2 列の H C 改質領域 7 3 を基板 4 の内部に形成してもよい。ここで、基板 4 はシリコンからなり、その厚さは 3 0 0 μ m である。各改質領域 7 1、7 2、7 3 の形成条件は下記の表 8 の通りである。なお、各改質領域 7 1、7 2、7 3 を形成する際のレーザ光 L のパルス幅は 1 5 0 n s であり、レーザ光照射位置の間隔は、品質改質領域 7 1 で 4 μ m、分断改質領域 7 2 (表面 3 側) で 1 μ m、分断改質領域 7 2 (裏面 2 1 側) で 4 μ m、H C 改質領域 7 3 (表面 3 側) で 4 μ m、H C 改質領域 7 3 (裏面 2 1 側) で 4 μ m である。

【 0 1 0 4 】

【表 8】

	集光点位置 (μm)	エネルギー (μJ)
品質改質領域 71	256	15
分断改質領域 72 (表面 3 側)	153	20
分断改質領域 72 (裏面 21 側)	121	20
HC改質領域 73 (表面 3 側)	71	10
HC改質領域 73 (裏面 21 側)	39	10

【 0 1 0 5 】

更に、図 2 8 に示すように、基板 4 の表面 3 側から順に、1 列の品質改質領域 7 1、1 9 列の分断改質領域 7 2、及び 2 列の H C 改質領域 7 3 を基板 4 の内部に形成してもよい。ここで、基板 4 はシリコンからなり、その厚さは 7 2 5 μ m である。各改質領域 7 1、7 2、7 3 の形成条件は下記の表 9 の通りである。なお、各改質領域 7 1、7 2、7 3 を形成する際のレーザ光 L のパルス幅は 1 5 0 n s であり、レーザ光照射位置の間隔は 4 μ m である。

【 0 1 0 6 】

【表 9】

	集光点位置(μm)	エネルギー(μJ)
品質改質領域71	644	15
分断改質領域72(表面3側)	641	20
分断改質領域72	612	20
分断改質領域72	584	20
分断改質領域72	555	20
分断改質領域72	527	20
分断改質領域72	498	20
分断改質領域72	470	20
分断改質領域72	441	20
分断改質領域72	413	20
分断改質領域72	384	20
分断改質領域72	356	20
分断改質領域72	328	20
分断改質領域72	299	20
分断改質領域72	271	20
分断改質領域72	242	20
分断改質領域72	214	20
分断改質領域72	185	20
分断改質領域72	157	20
分断改質領域72(裏面21側)	121	20
HC改質領域73(表面3側)	71	10
HC改質領域73(裏面21側)	39	10

【0107】

なお、表1～表3において、集光点位置とは、レーザ光Lの集光点Pを合わせる位置の裏面21からの距離を意味し、エネルギーとは、各改質領域71，72，73を形成する際のレーザ光Lのエネルギーを意味する。

【図面の簡単な説明】

【0108】

【図1】本実施形態に係るレーザ加工方法によるレーザ加工中の加工対象物の平面図である。

【図2】図1に示す加工対象物のII－II線に沿っての断面図である。

【図3】本実施形態に係るレーザ加工方法によるレーザ加工後の加工対象物の平面図である。

【図4】図3に示す加工対象物のIV－IV線に沿っての断面図である。

【図5】図3に示す加工対象物のV－V線に沿っての断面図である。

【図6】本実施形態に係るレーザ加工方法により切断された加工対象物の平面図である。

【図7】本実施形態に係るレーザ加工方法における電界強度とクラックスポットの大きさとの関係を示すグラフである。

【図8】本実施形態に係るレーザ加工方法の第1工程における加工対象物の断面図である。

【図9】本実施形態に係るレーザ加工方法の第2工程における加工対象物の断面図である。

【図10】本実施形態に係るレーザ加工方法の第3工程における加工対象物の断面図である。

【図11】本実施形態に係るレーザ加工方法の第4工程における加工対象物の断面図

である。

【図 1 2】 本実施形態に係るレーザ加工方法により切断されたシリコンウェハの一部における断面の写真を表した図である。

【図 1 3】 本実施形態に係るレーザ加工方法におけるレーザ光の波長とシリコン基板の内部の透過率との関係を示すグラフである。

【図 1 4】 本実施形態のレーザ加工方法における加工対象物の平面図である。

【図 1 5】 図 1 4 に示す加工対象物のXV-XV線に沿っての部分断面図である。

【図 1 6】 本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図であり、(a)は、加工対象物に保護テープを貼り付けた状態、(b)は、加工対象物にレーザ光を照射している状態である。

【図 1 7】 本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図であり、(a)は、加工対象物にエキスパンドテープを貼り付けた状態、(b)は、保護テープに紫外線を照射している状態である。

【図 1 8】 本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図であり、(a)は、加工対象物から保護テープを剥がした状態、(b)は、エキスパンドテープを拡張させた状態である。

【図 1 9】 図 1 6 (b) に示す加工対象物のXIX-XIX線に沿っての部分断面図である。

【図 2 0】 本実施形態のレーザ加工方法の使用により切断された基板の切断面の写真を表した図である。

【図 2 1】 HC改質領域を形成する際にレーザ光の集光点を合わせる位置の裏面からの距離を $40\mu\text{m}$ 、レーザ光のエネルギーを $20\mu\text{J}$ とした場合における基板の裏面の写真を表した図である。

【図 2 2】 HC改質領域を形成する際にレーザ光の集光点を合わせる位置の裏面からの距離を $15\mu\text{m}$ 、レーザ光のエネルギーを $10\mu\text{J}$ とした場合における基板の裏面の写真を表した図である。

【図 2 3】 品質改質領域の形成条件とスカート幅との関係を示す表である。

【図 2 4】 品質改質領域を形成する際にレーザ光の集光点を合わせる位置の表面からの距離を $3\mu\text{m}$ 、レーザ光のエネルギーを $15\mu\text{J}$ とした場合における基板の切断面の写真を表した図である。

【図 2 5】 加工対象物を半導体チップに切断した際の平面図であり、(a)は、分断改質領域の形成において分断改質領域についての各種形成条件を満たしていない場合、(b)は、分断改質領域の形成において分断改質領域についての各種形成条件を満たしている場合である。

【図 2 6】 1列の品質改質領域、2列の分断改質領域、及び1列のHC改質領域が形成された基板の切断面の写真を表した図である。

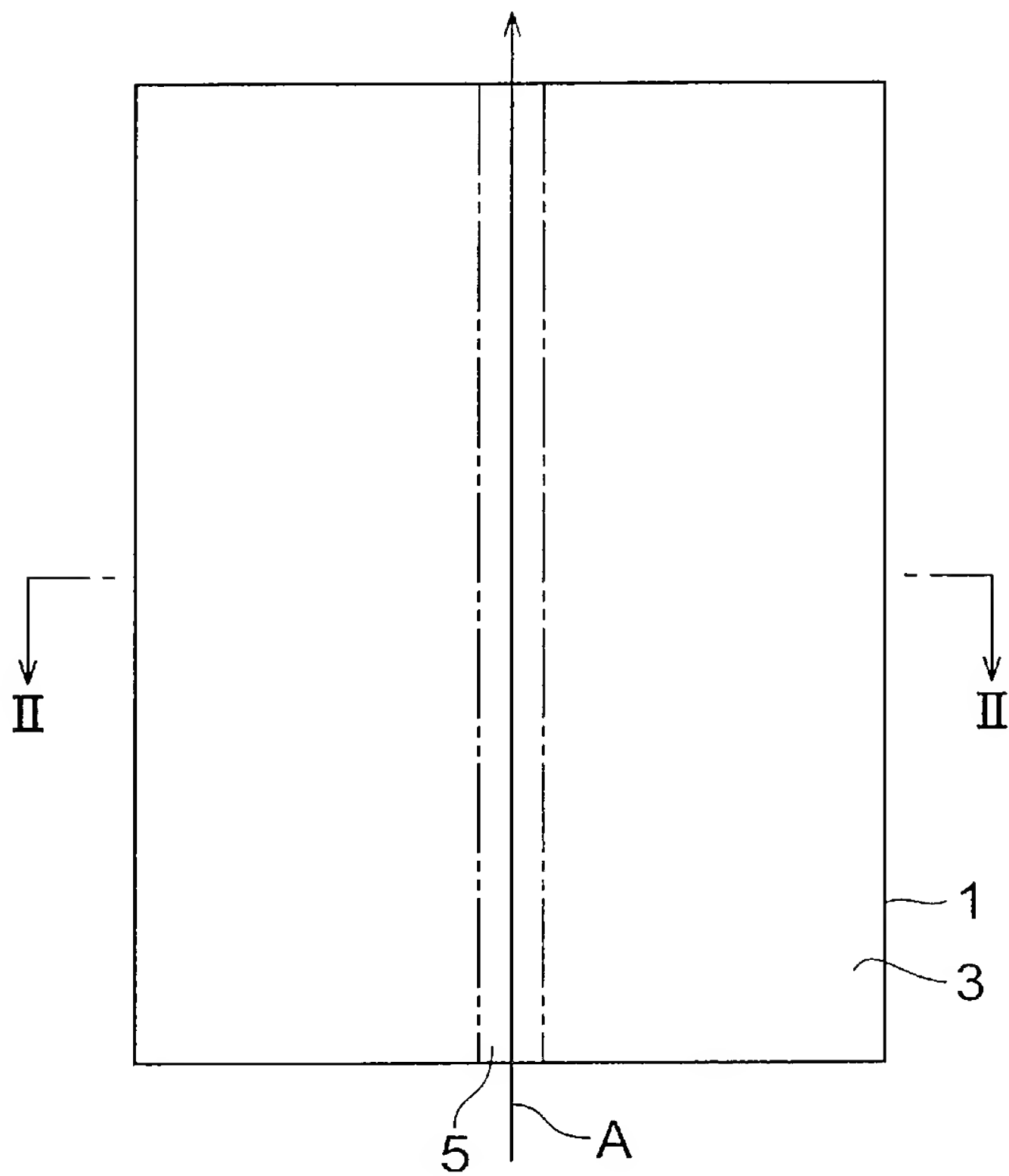
【図 2 7】 1列の品質改質領域、2列の分断改質領域、及び2列のHC改質領域が形成された基板の切断面の写真を表した図である。

【図 2 8】 1列の品質改質領域、19領域の分断改質領域、及び2列のHC改質領域が形成された基板の切断面の写真を表した図である。

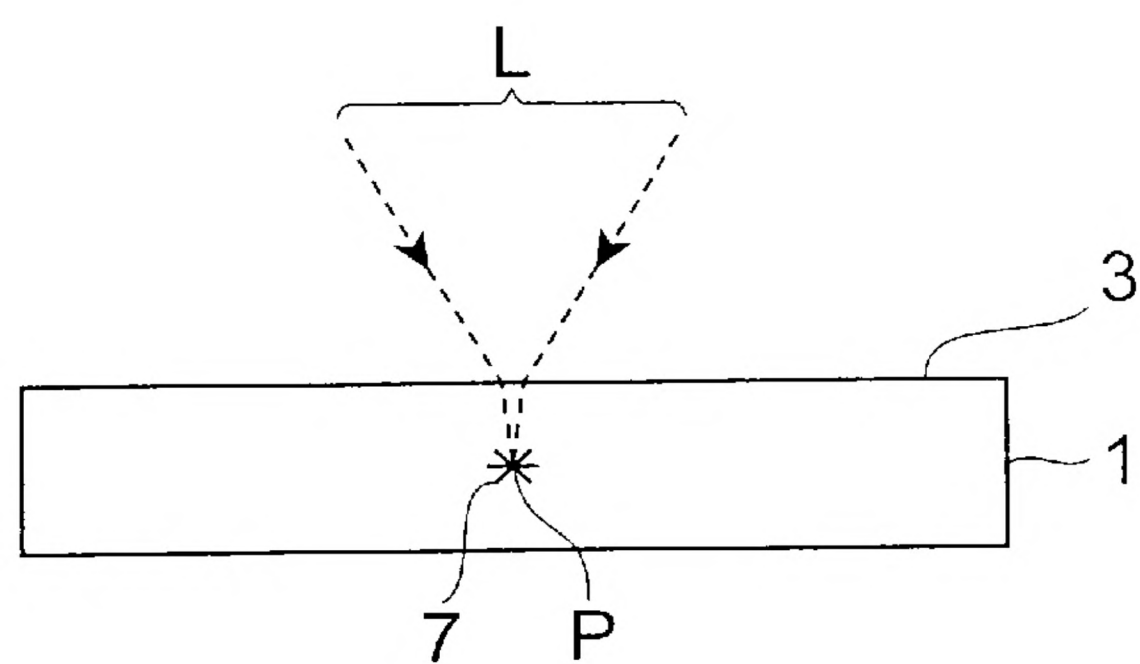
【符号の説明】

【0109】

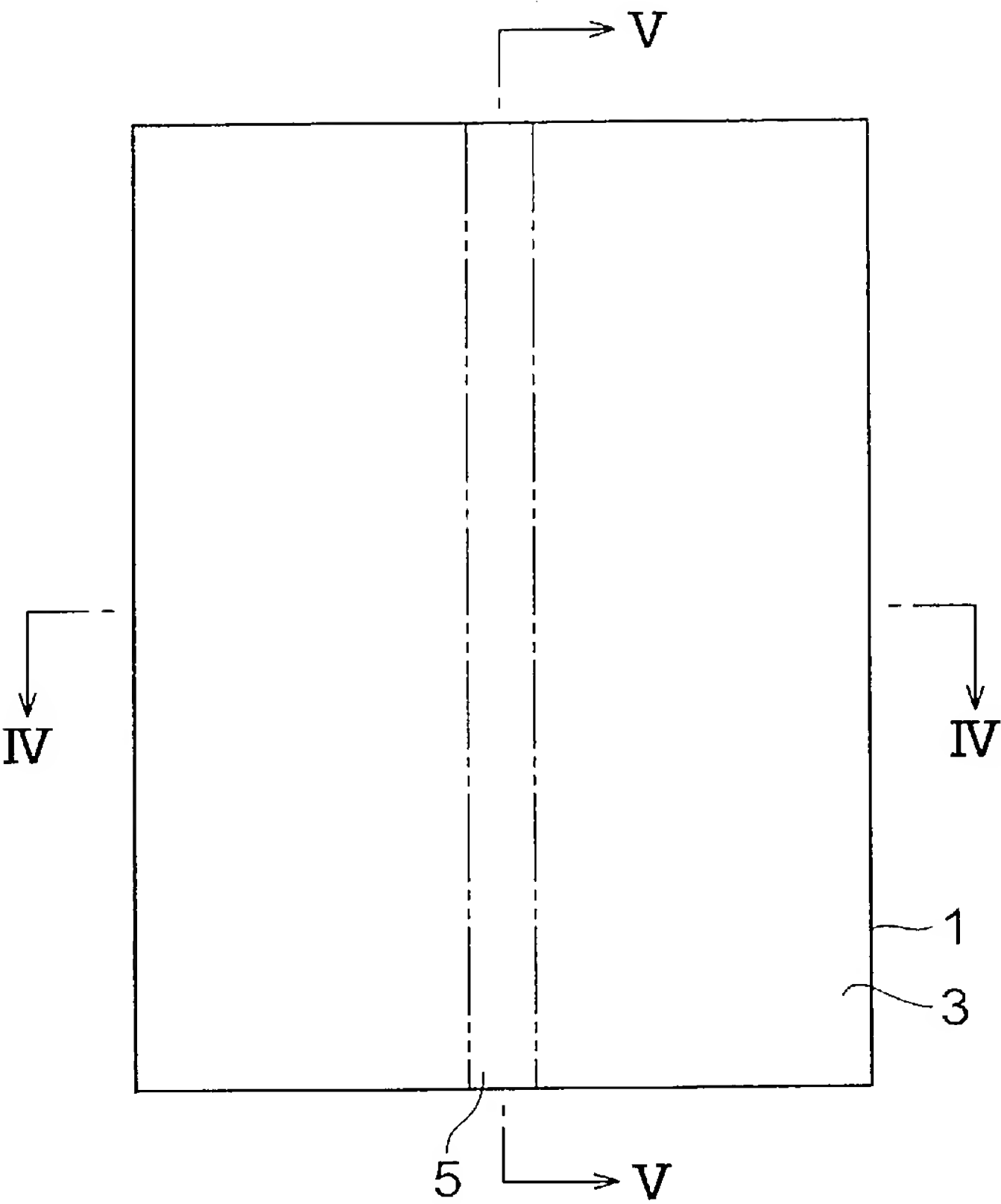
1…加工対象物、3…表面、4…基板、4a…切断面(側面)、5…切断予定ライン、7…改質領域、8…切断起点領域、13…熔融処理領域、15…機能素子、16…積層部、21…裏面、24…割れ、25…半導体チップ、71…品質改質領域、72…分断改質領域(第1の改質領域)、73…HC改質領域(第2の改質領域)、L…レーザ光、P…集光点。



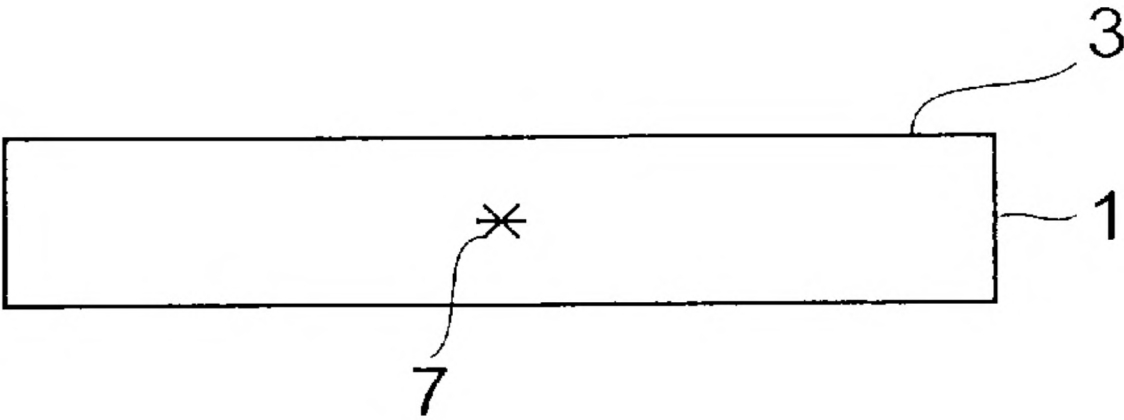
【図 2】

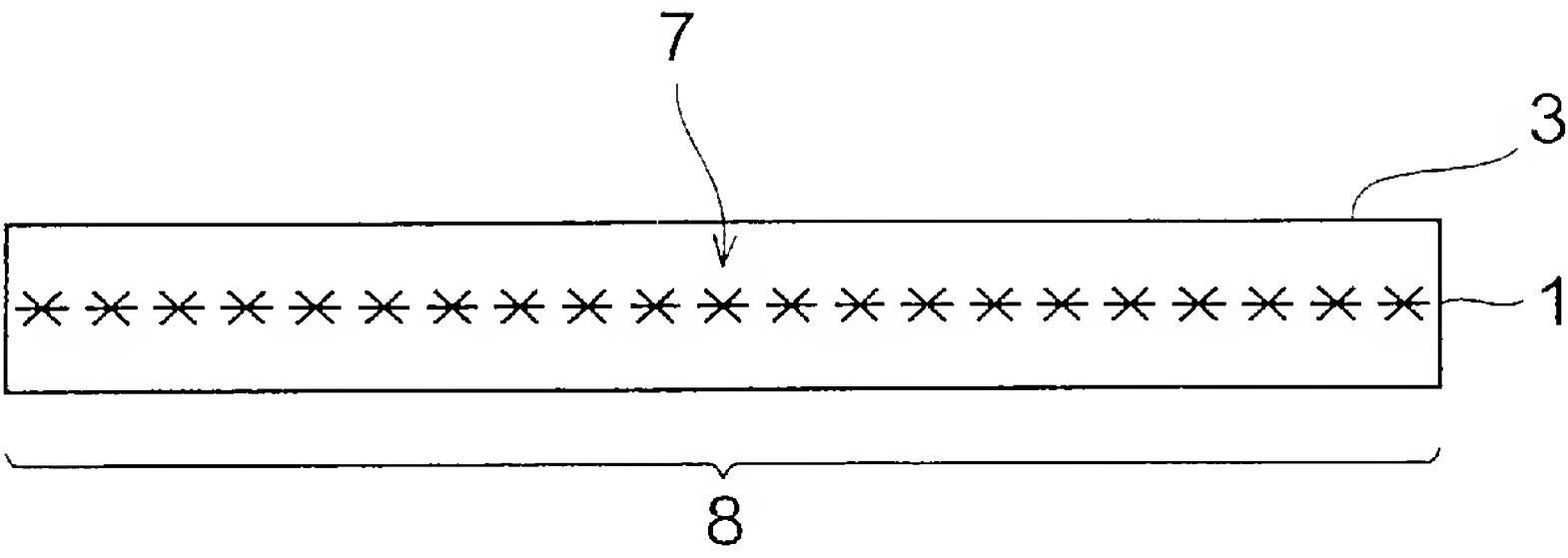


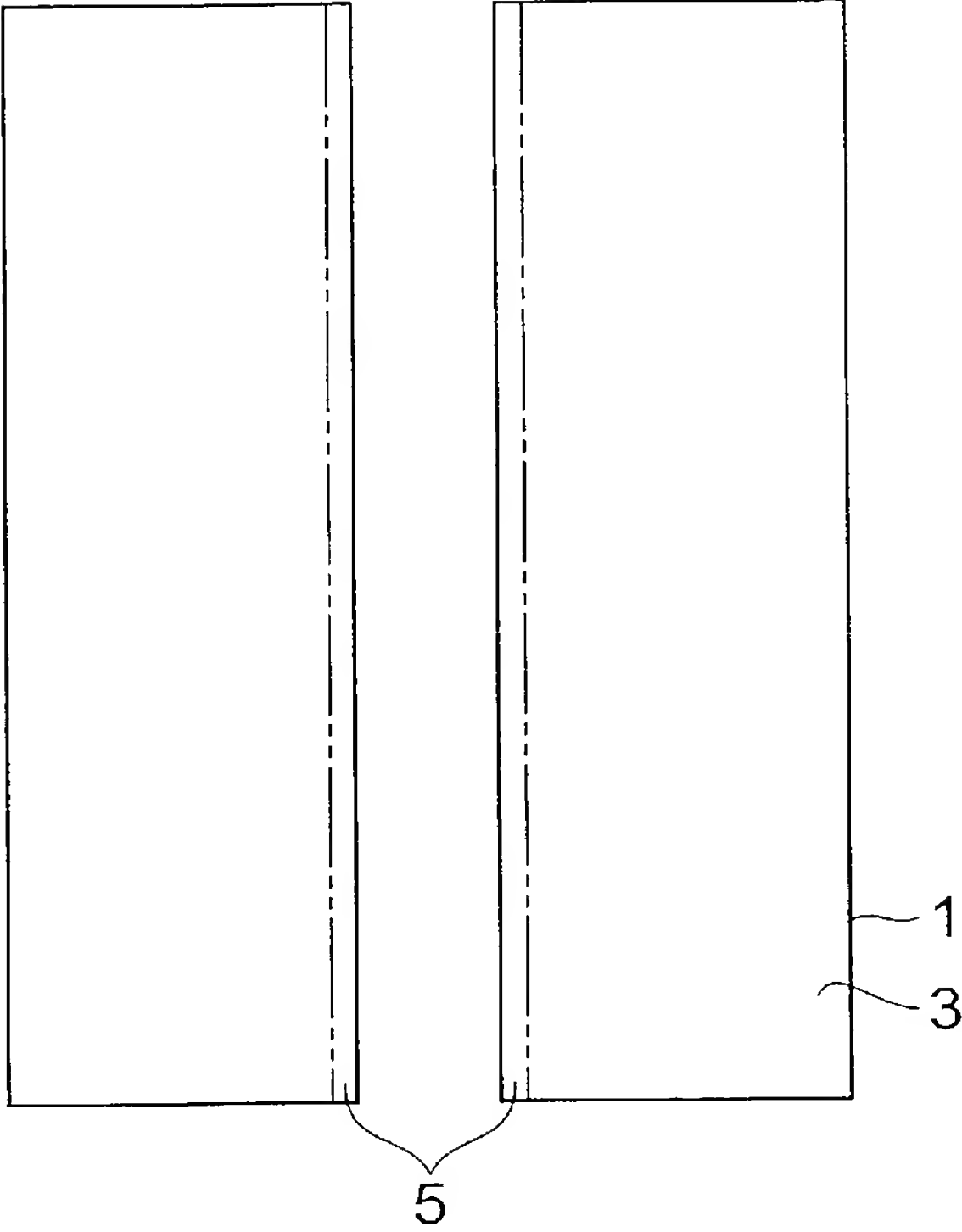
【 図 3 】

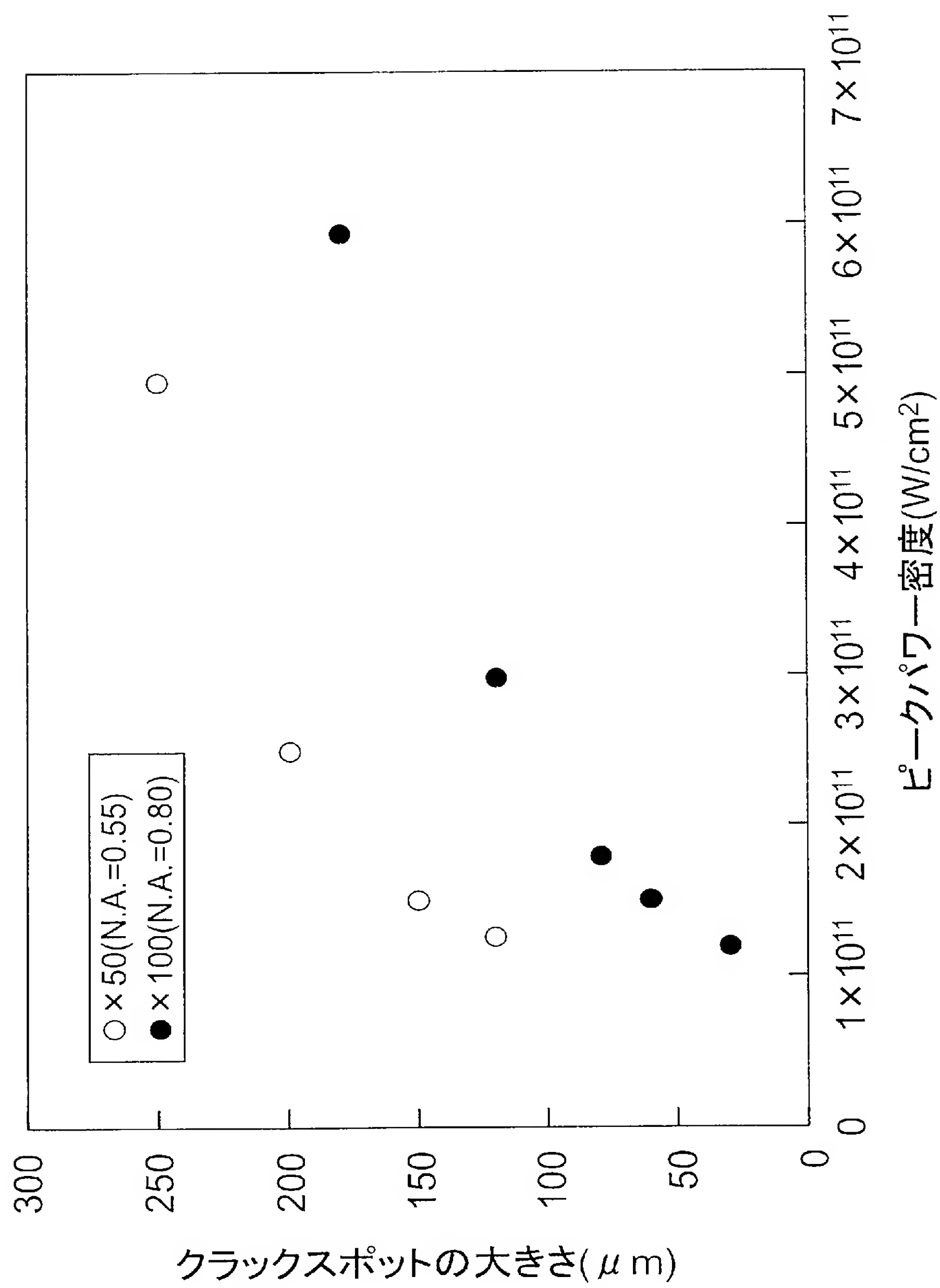


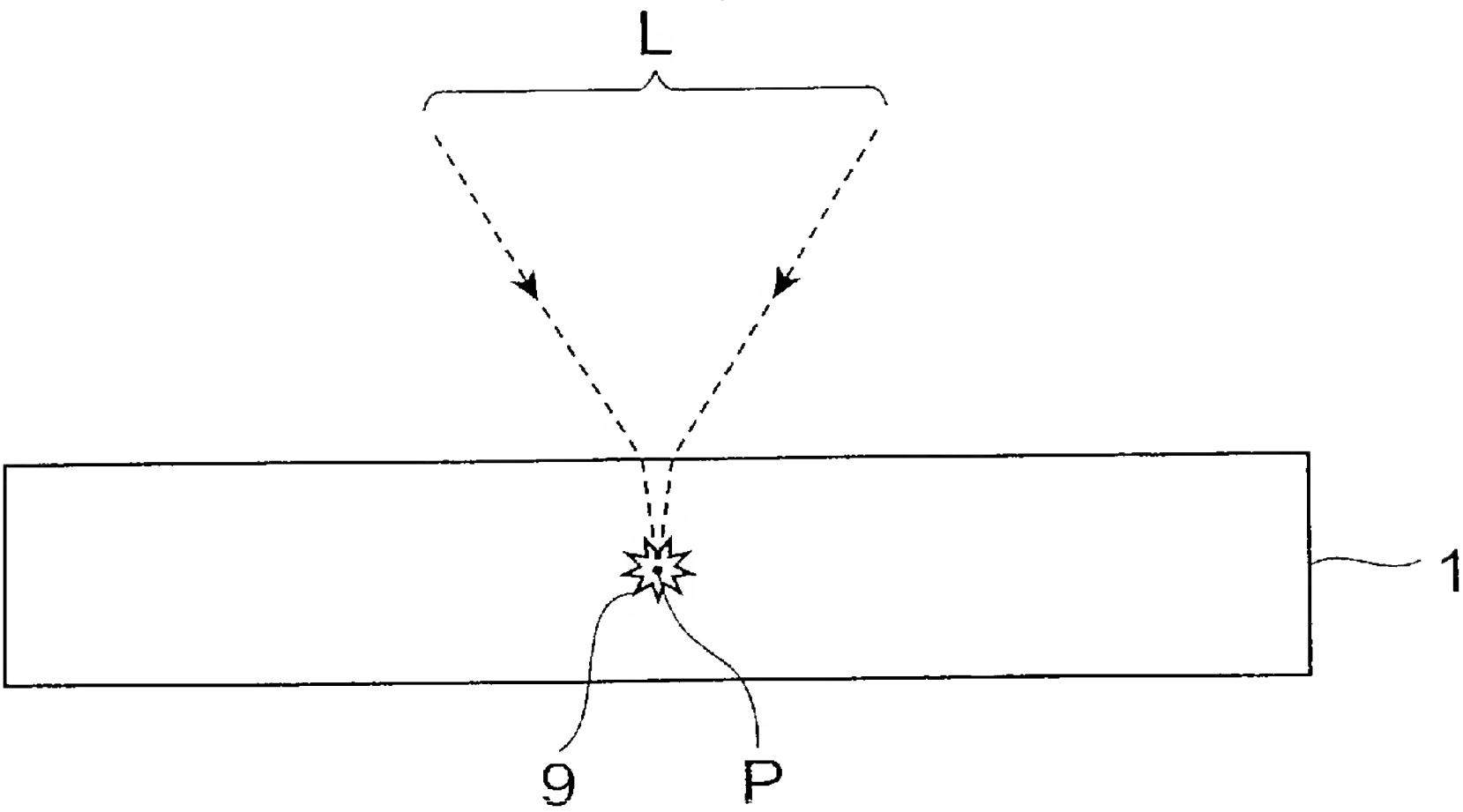
【 図 4 】

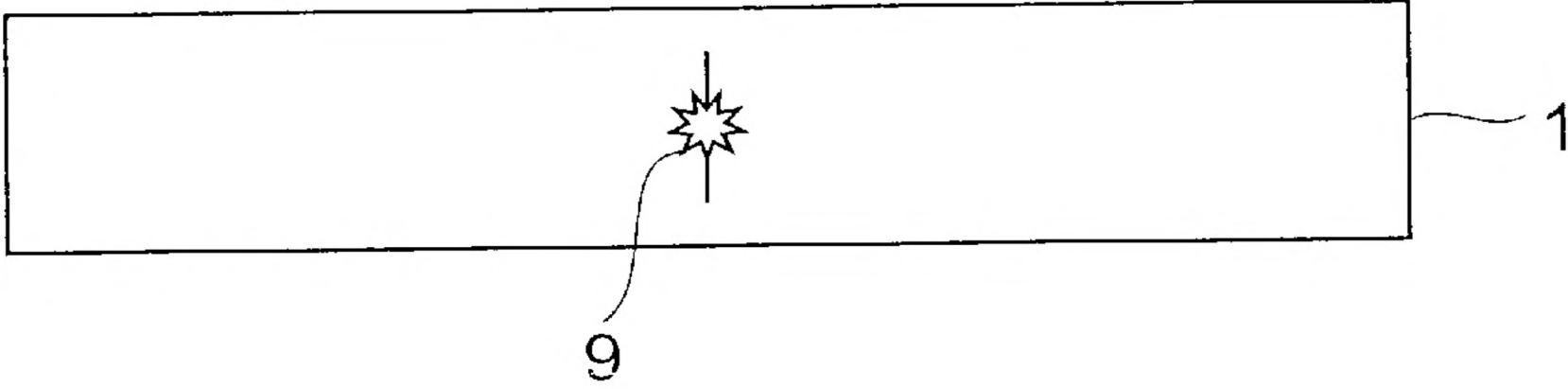


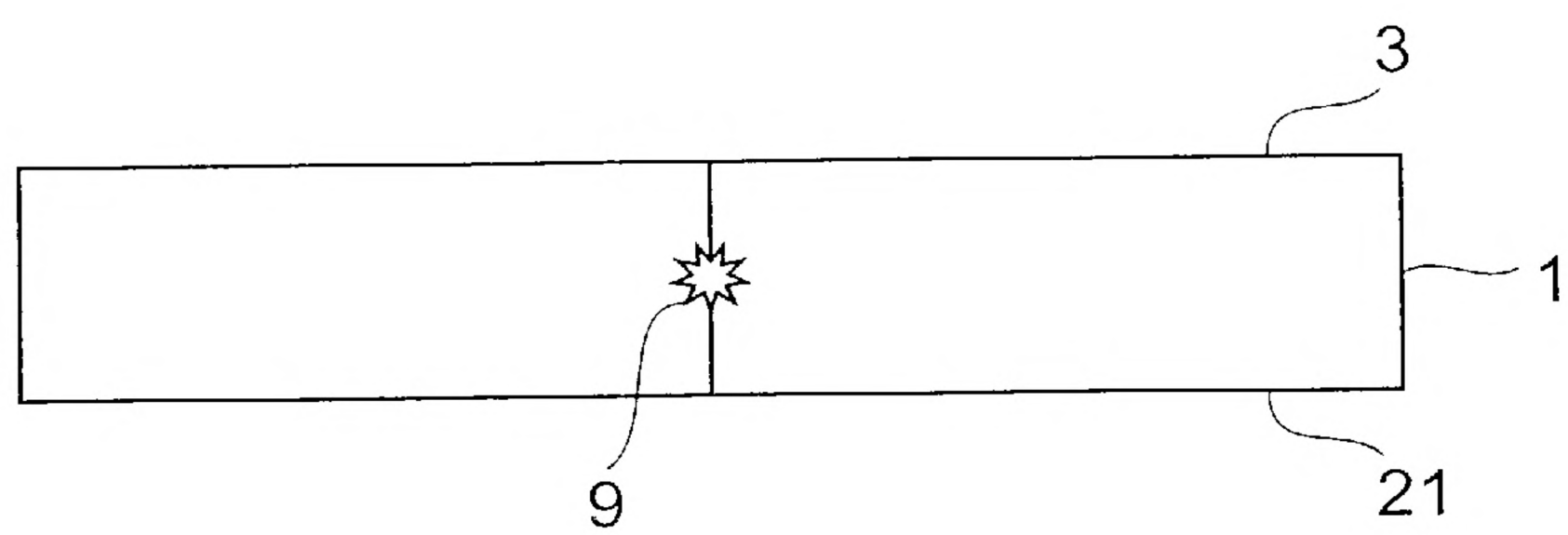


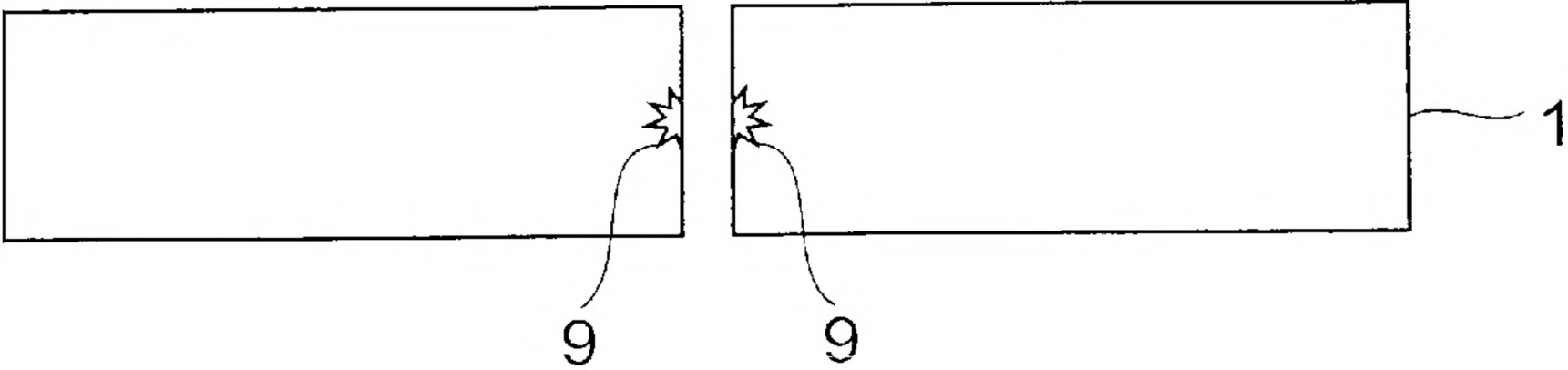


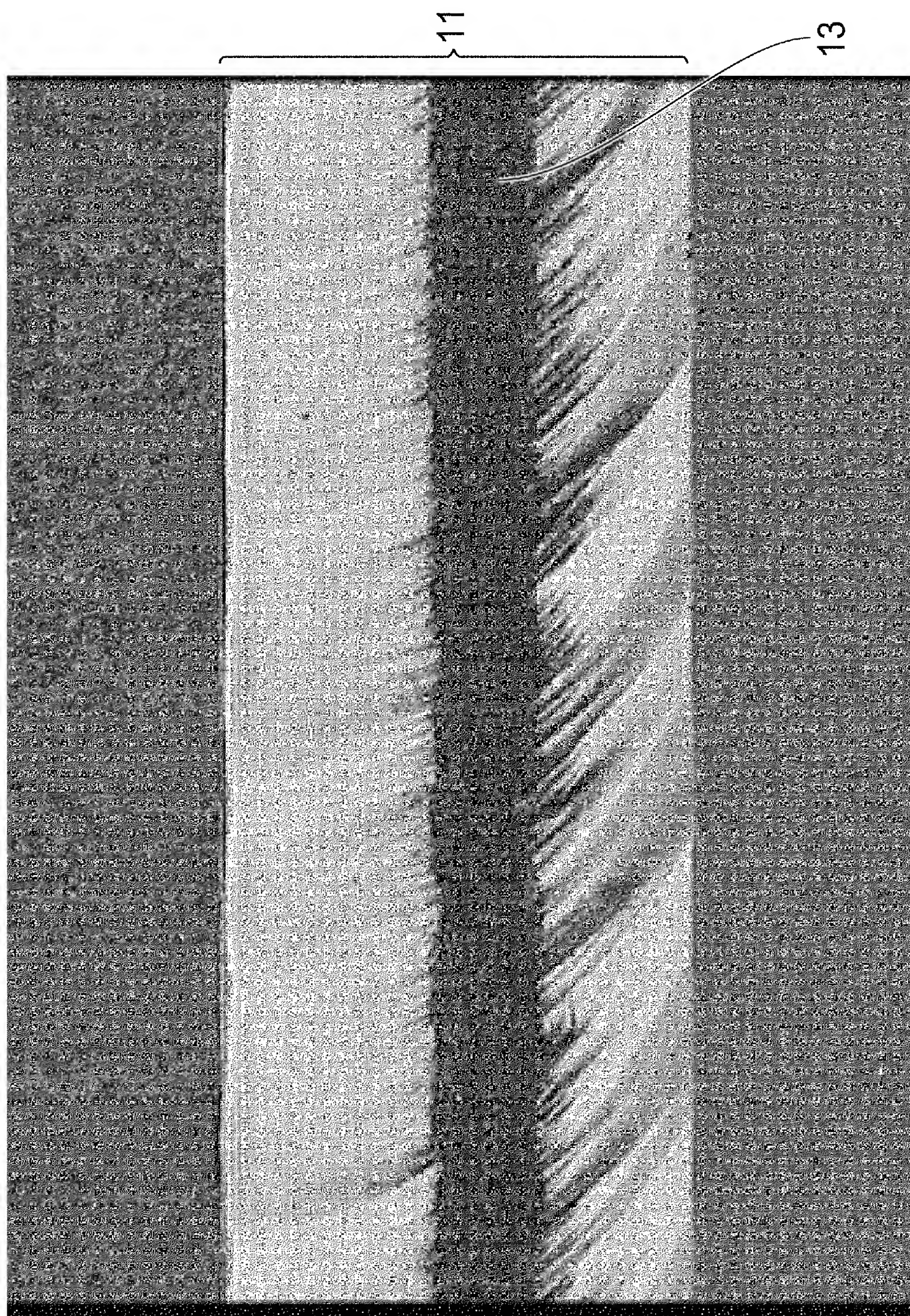


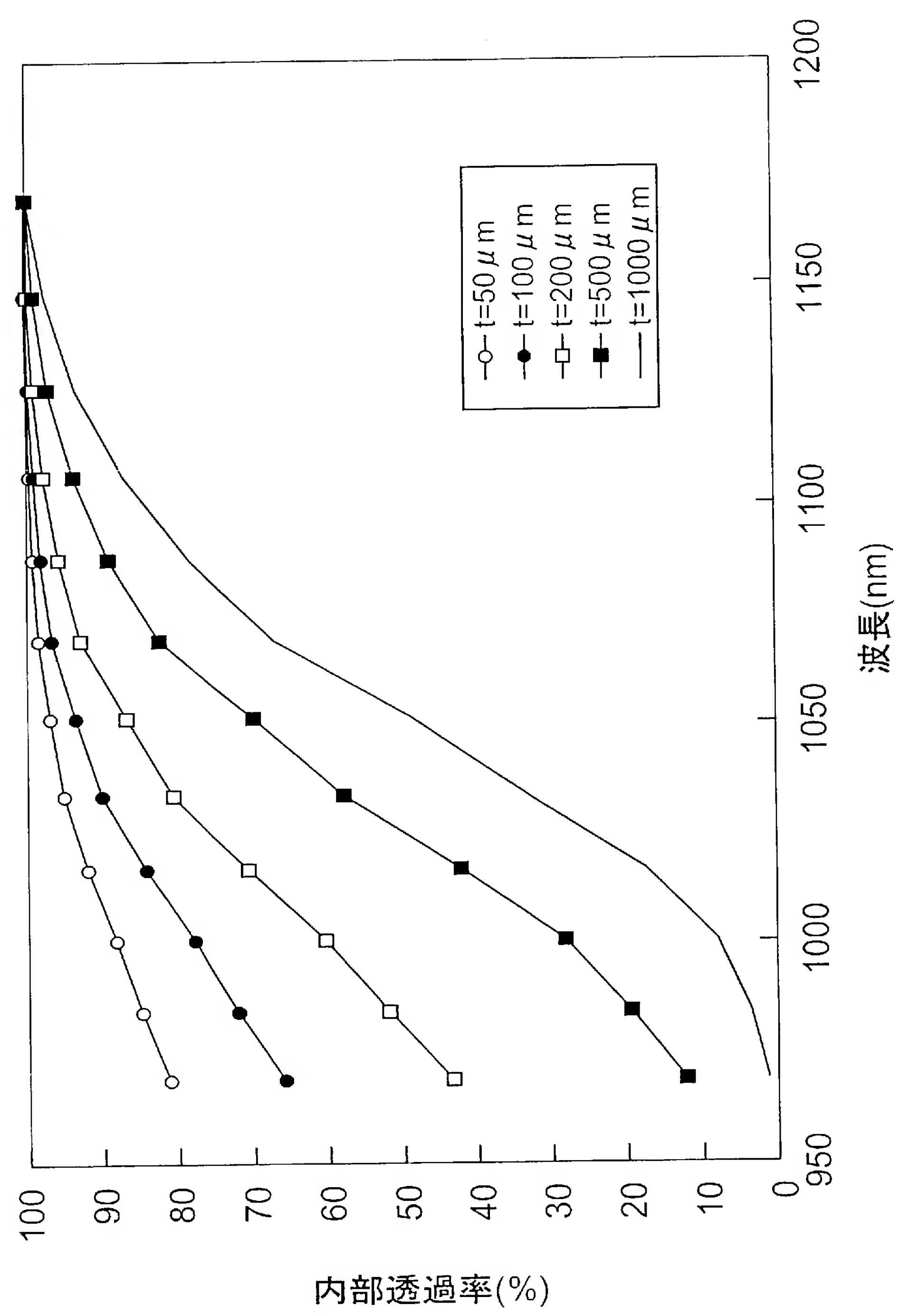


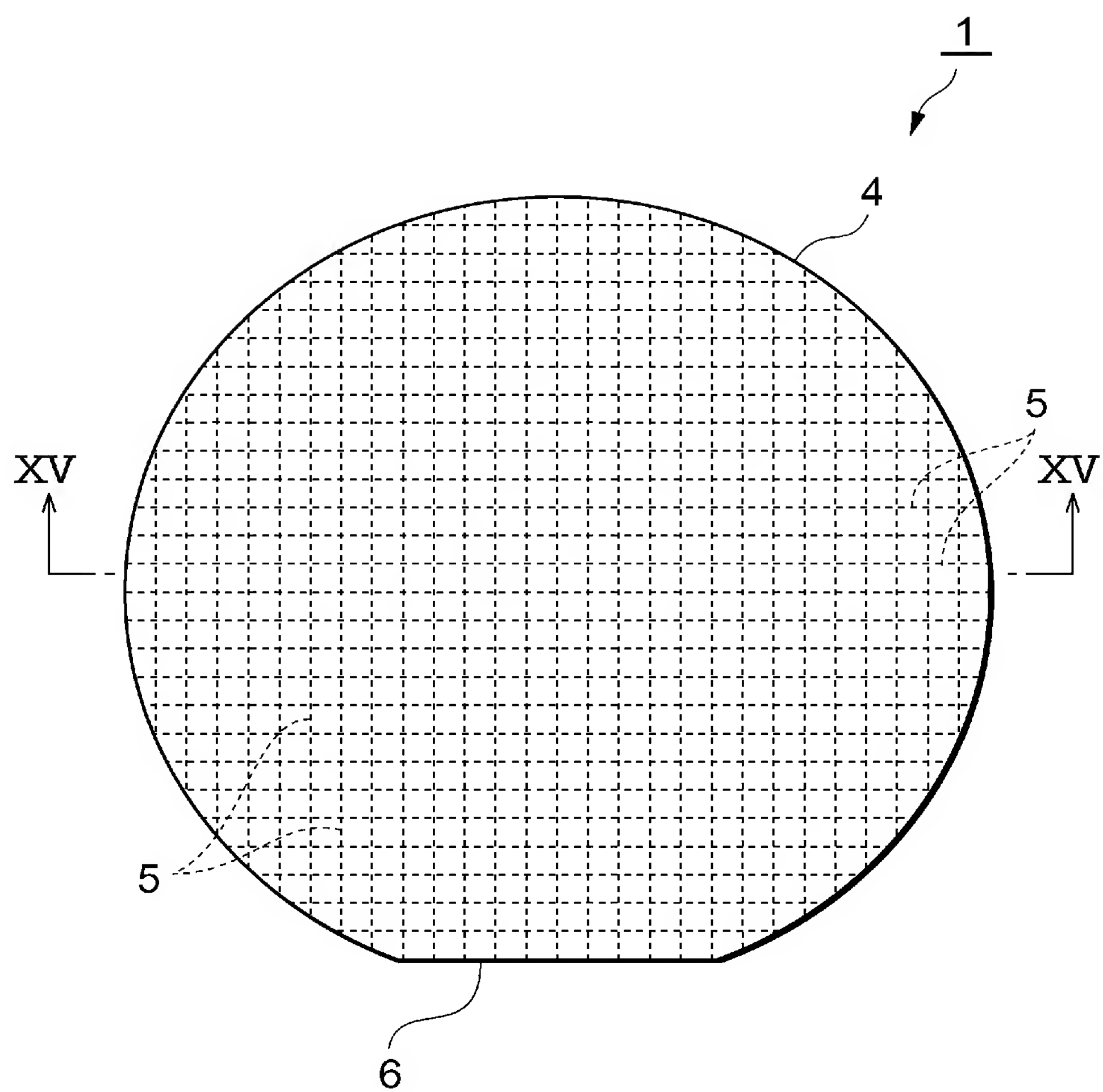


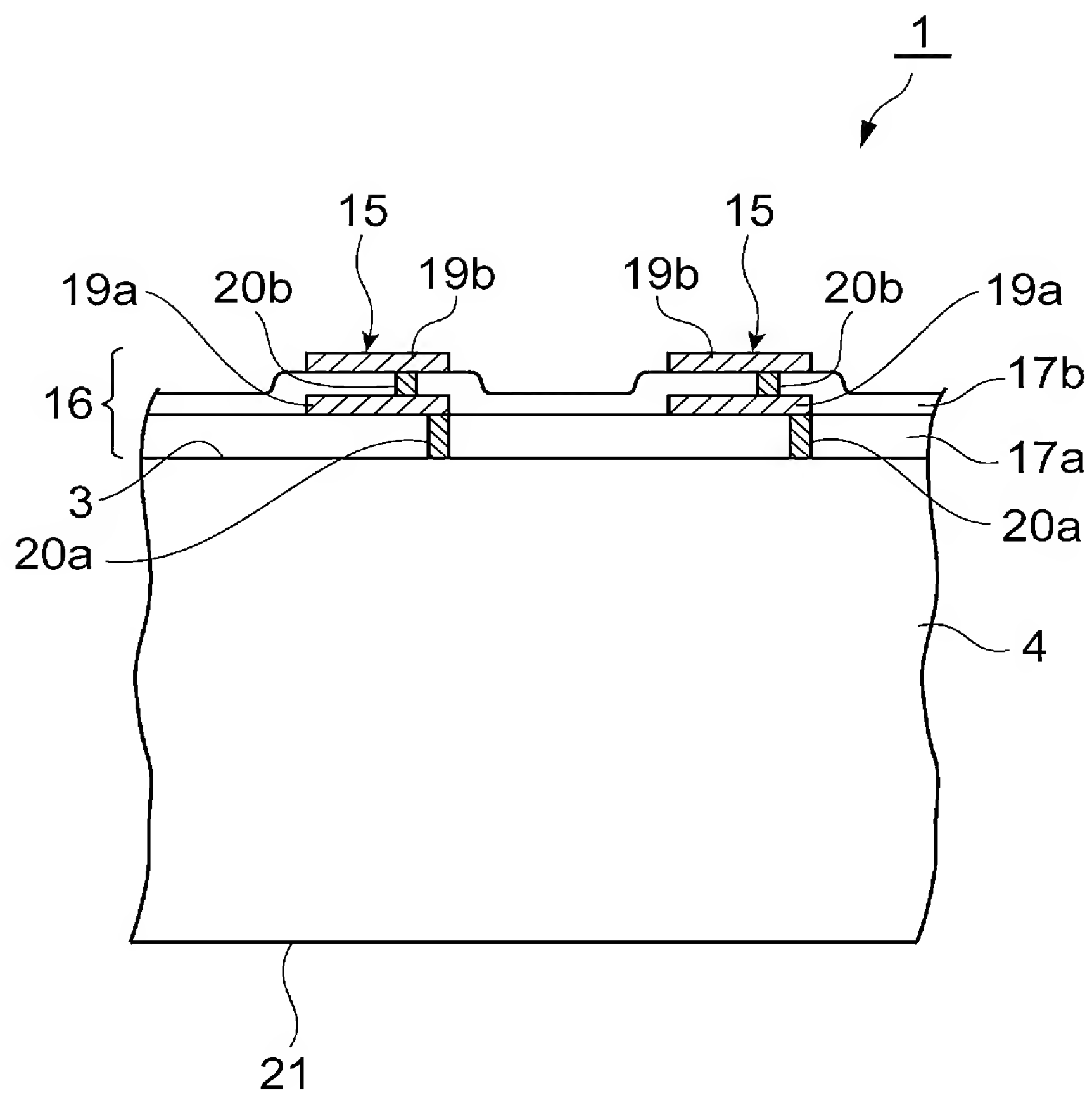


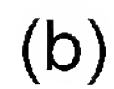
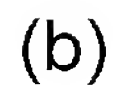




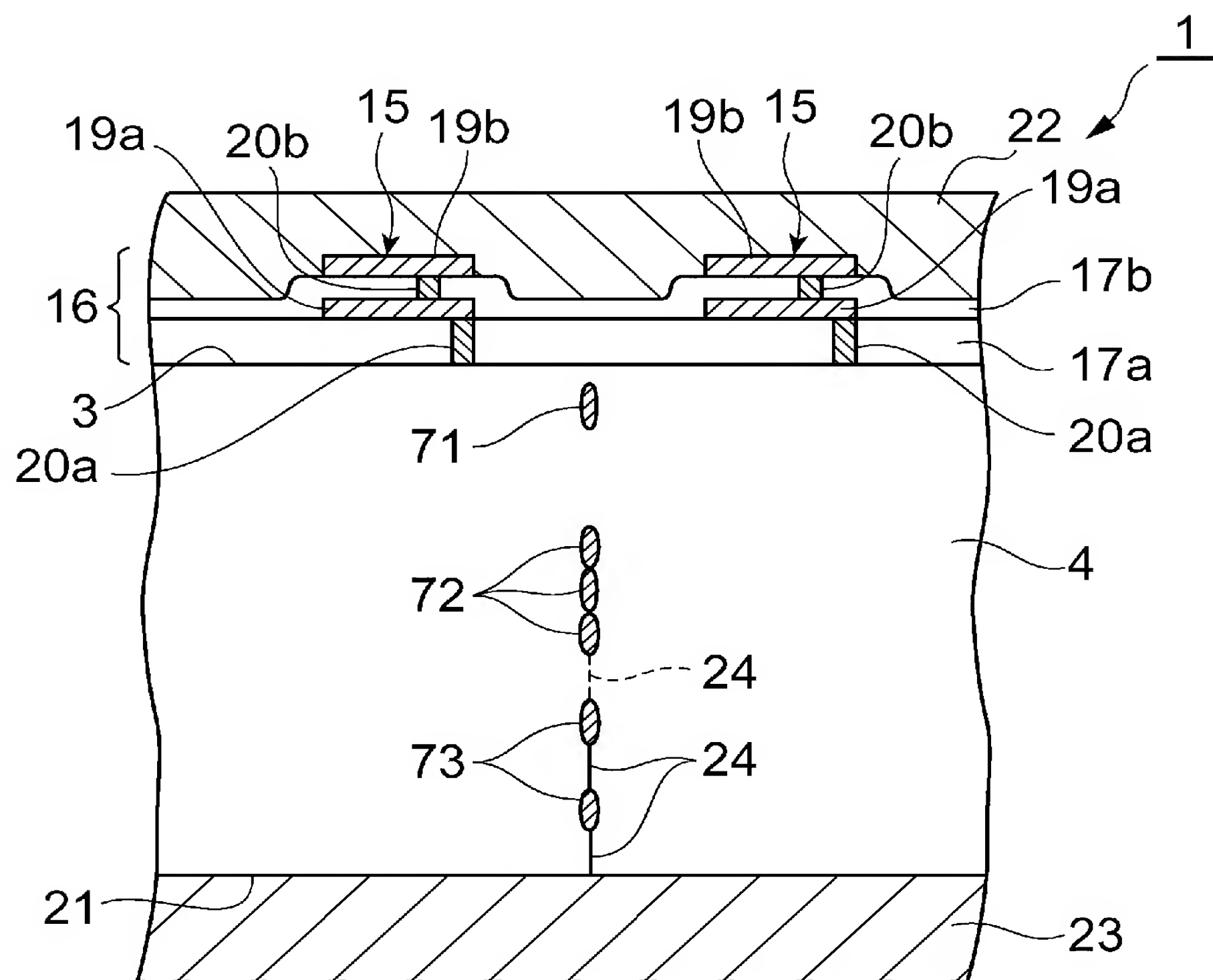




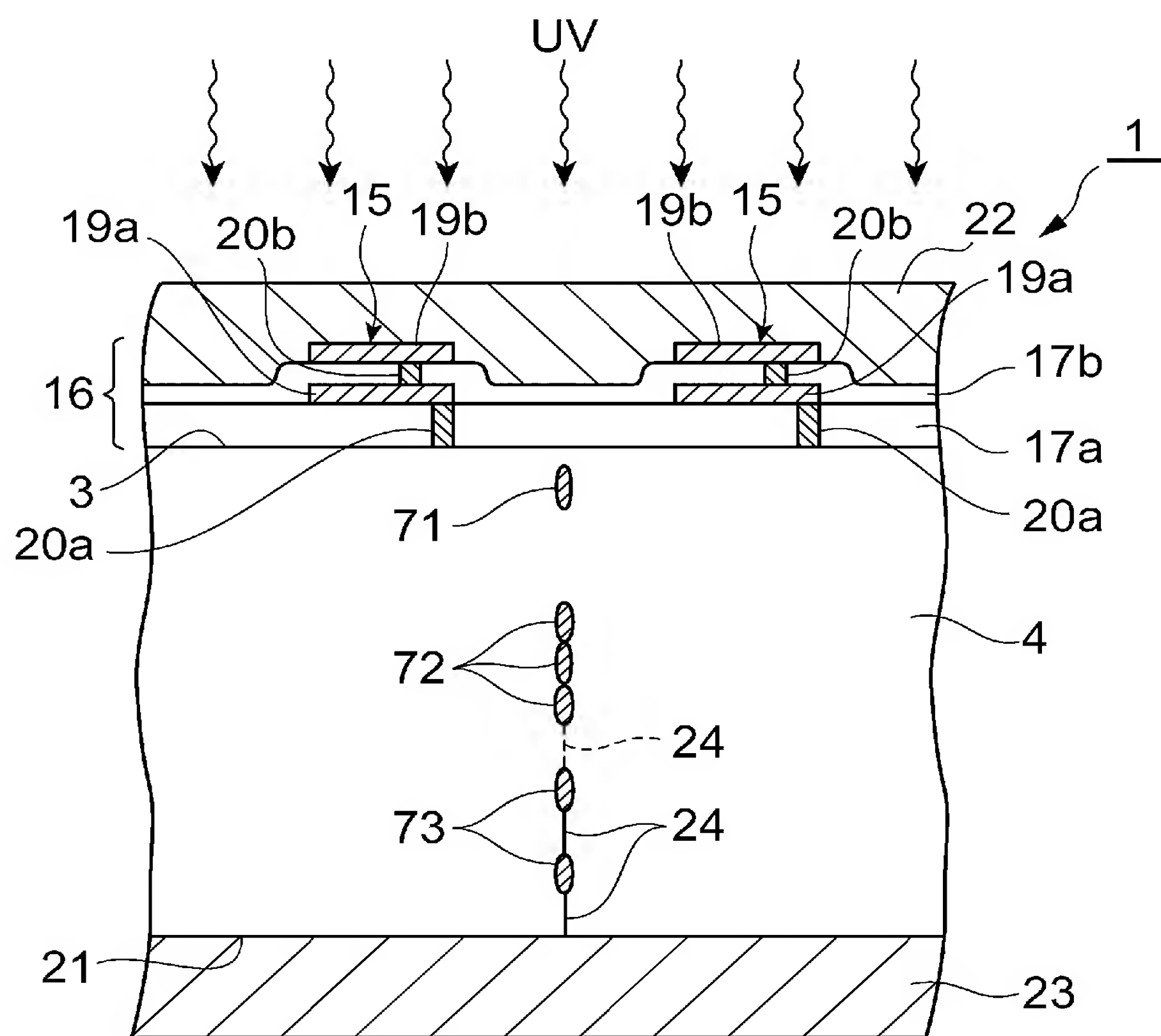




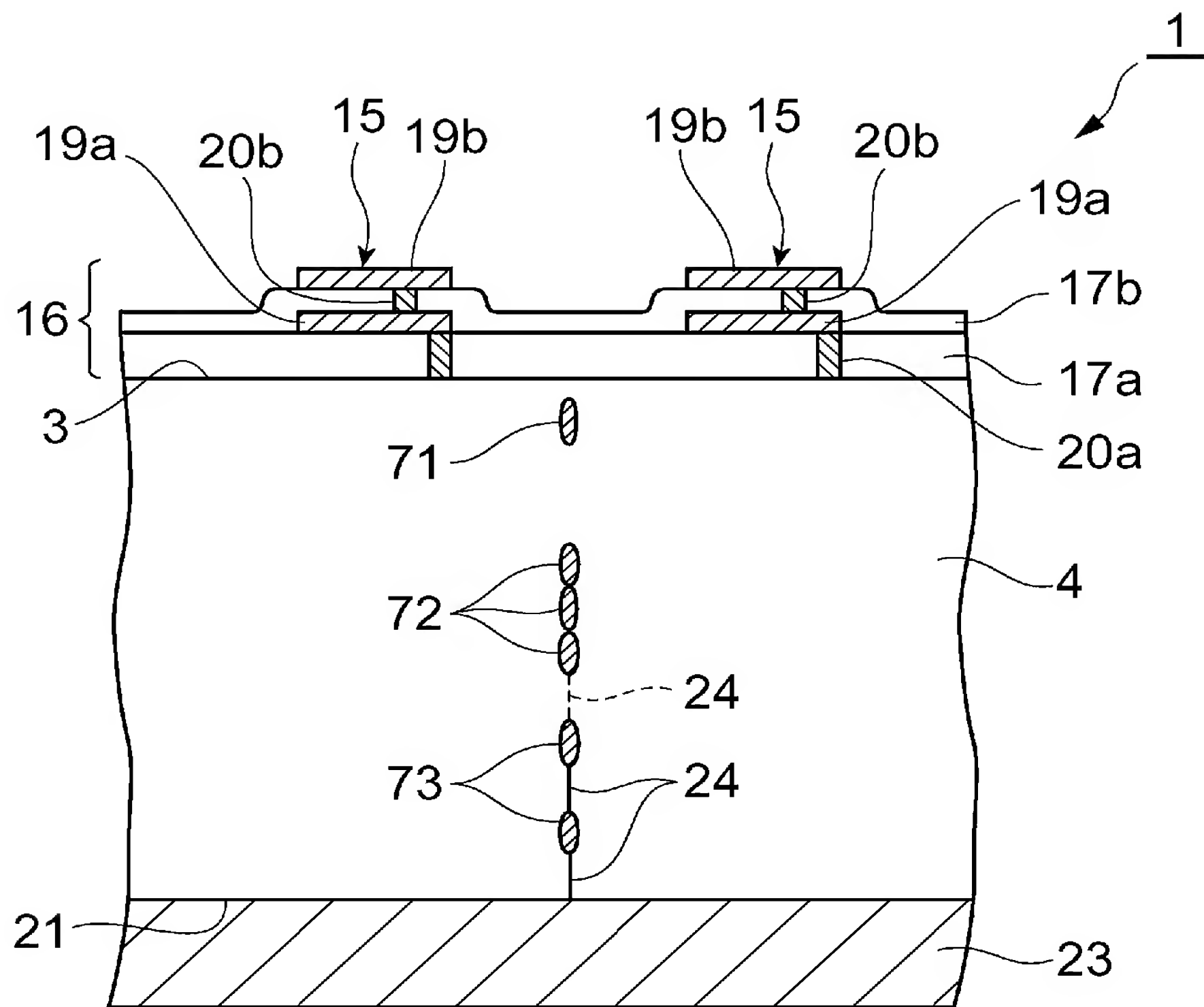
(a)



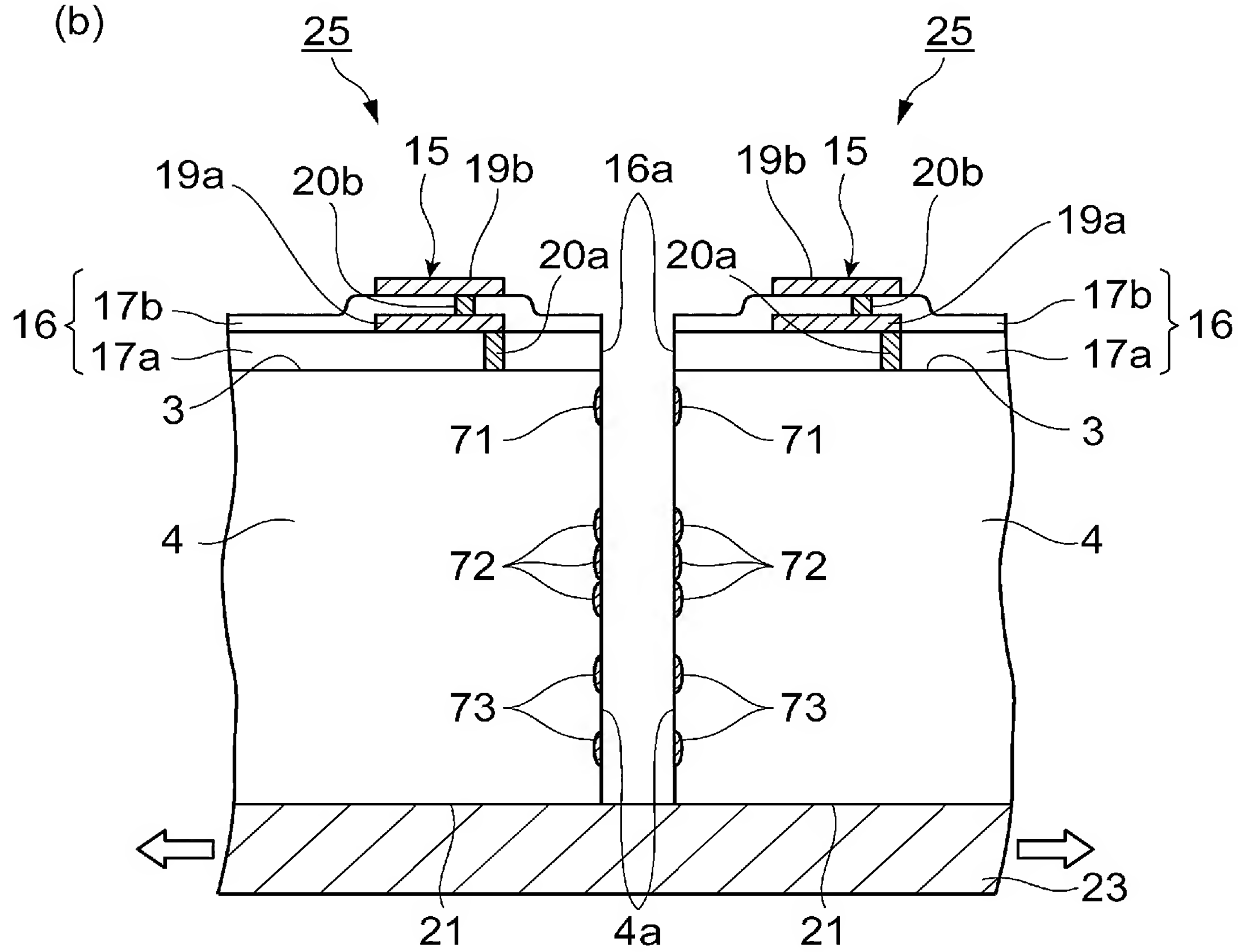
(b)

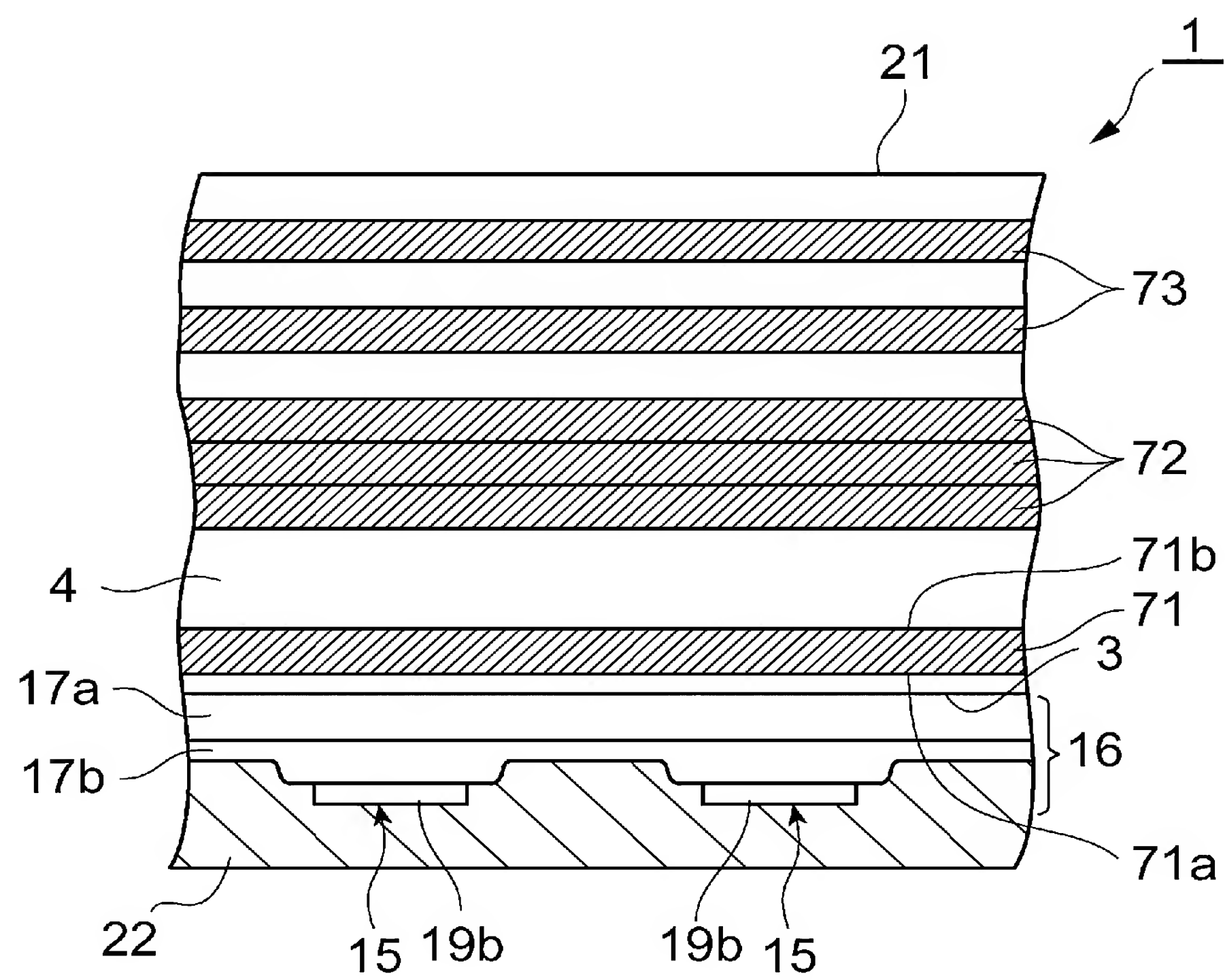


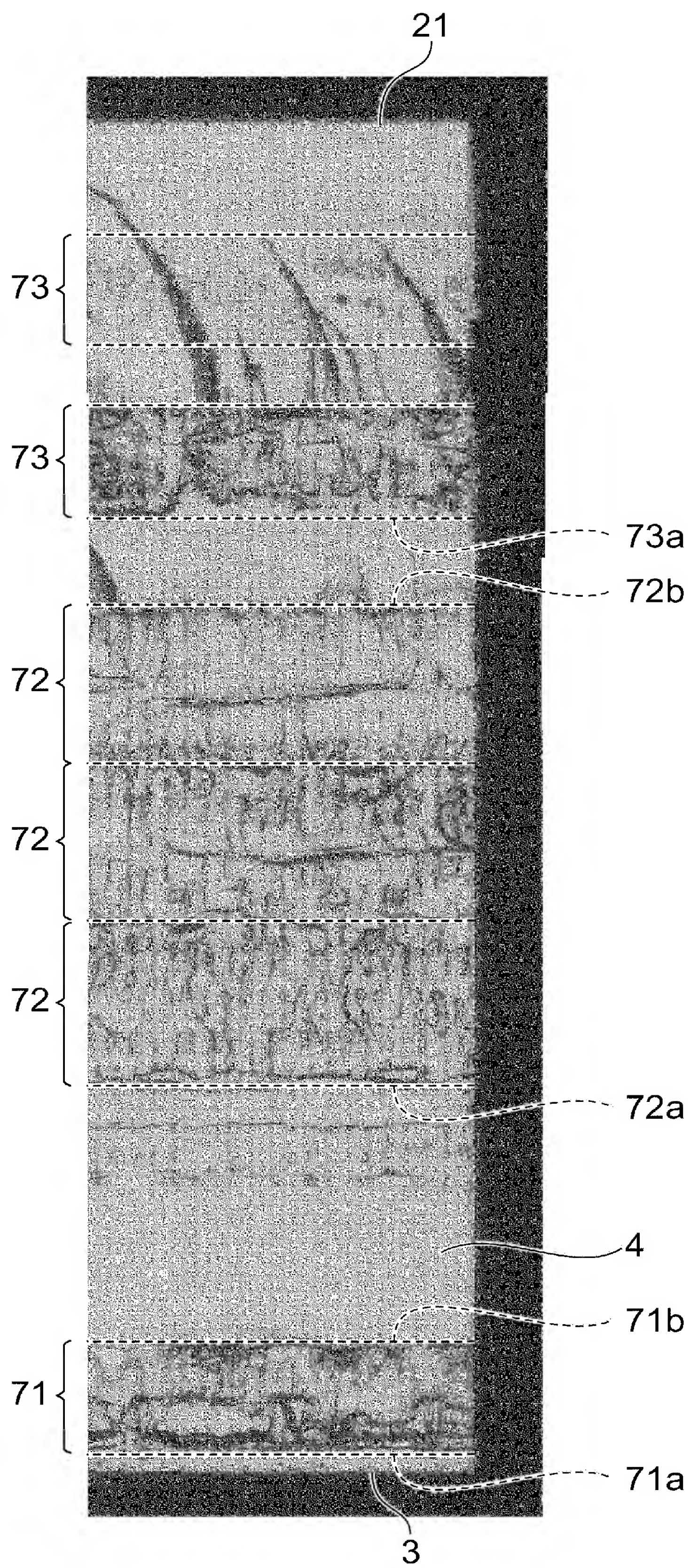
(a)

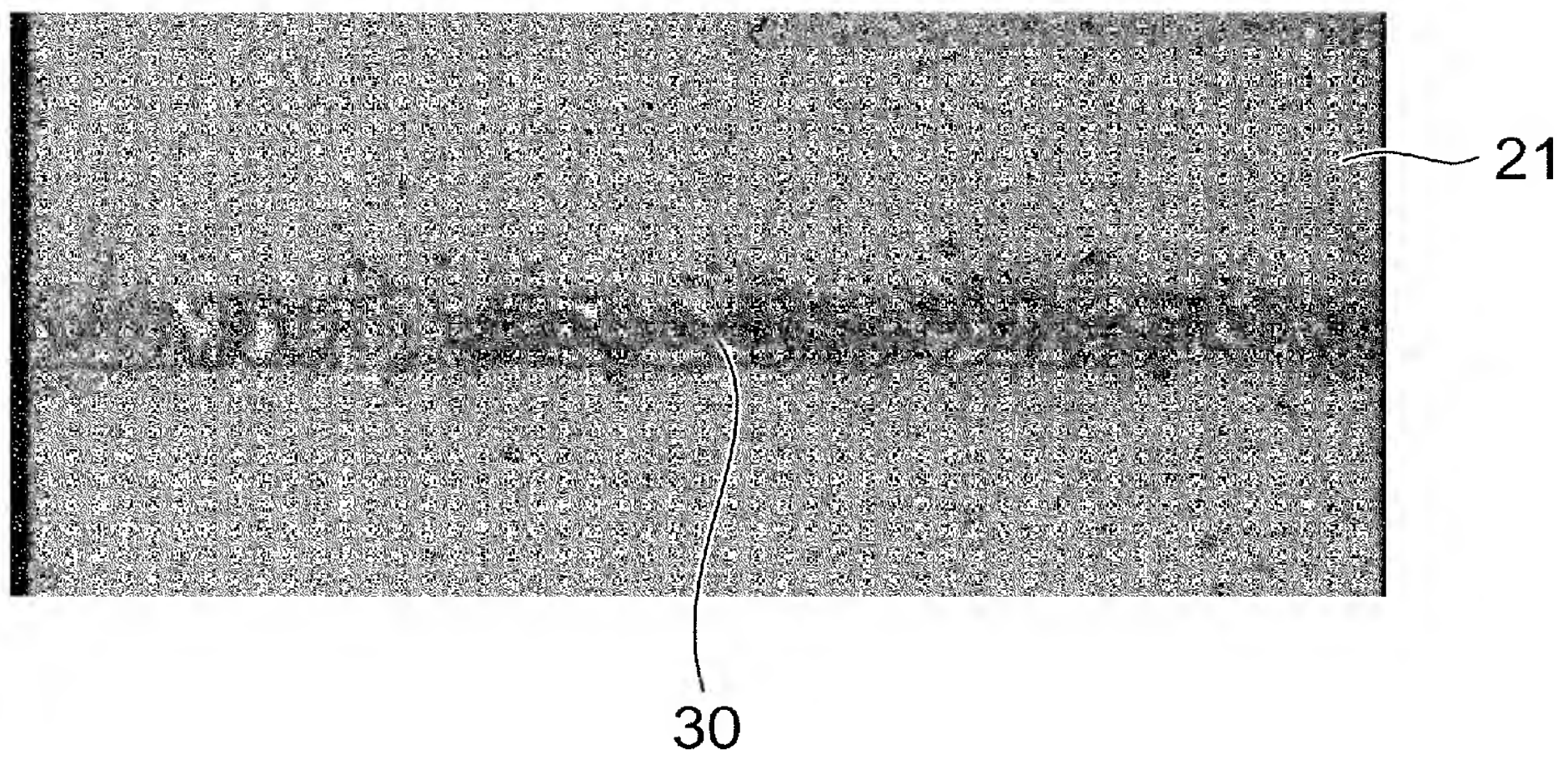


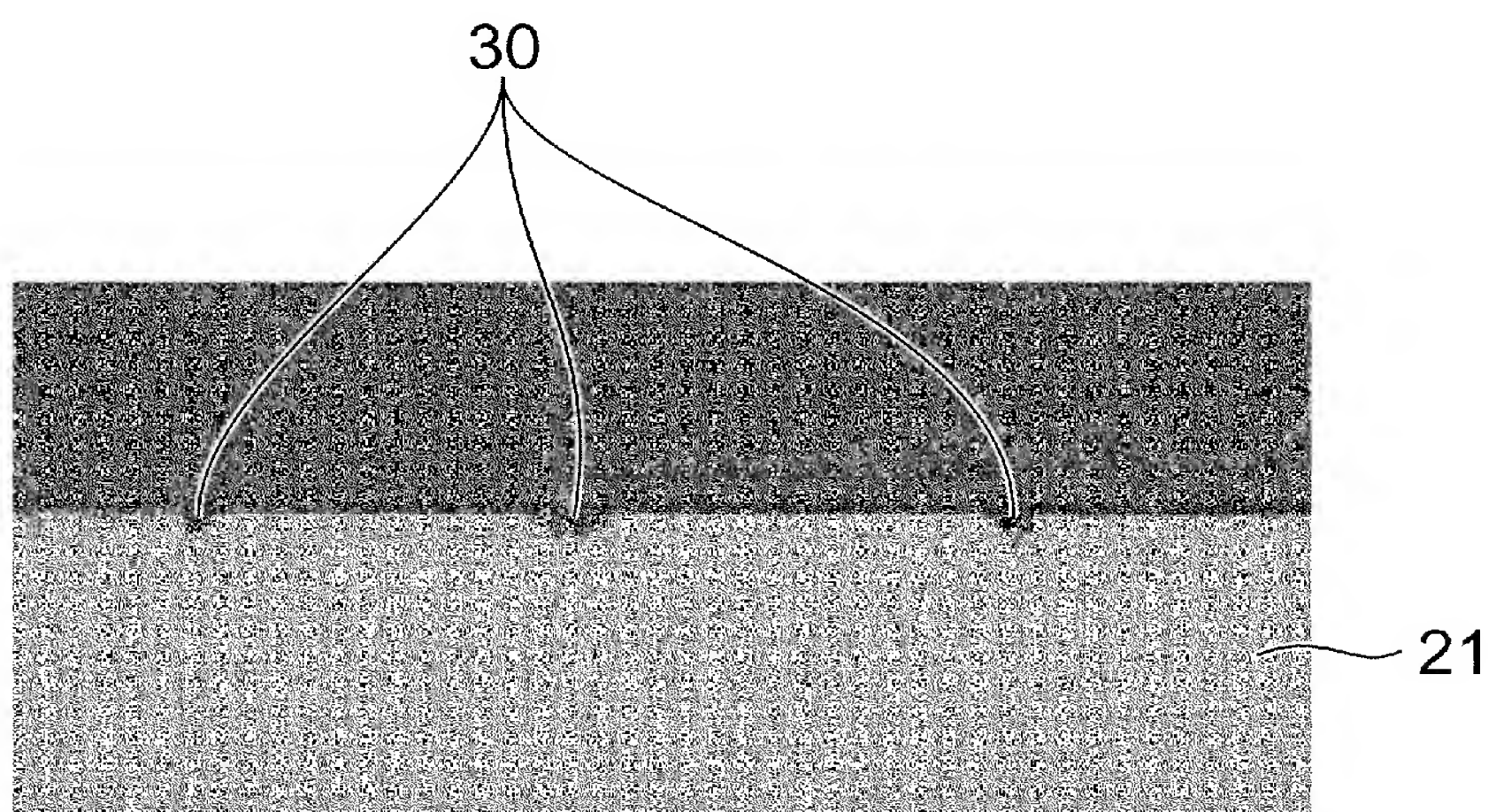
(b)

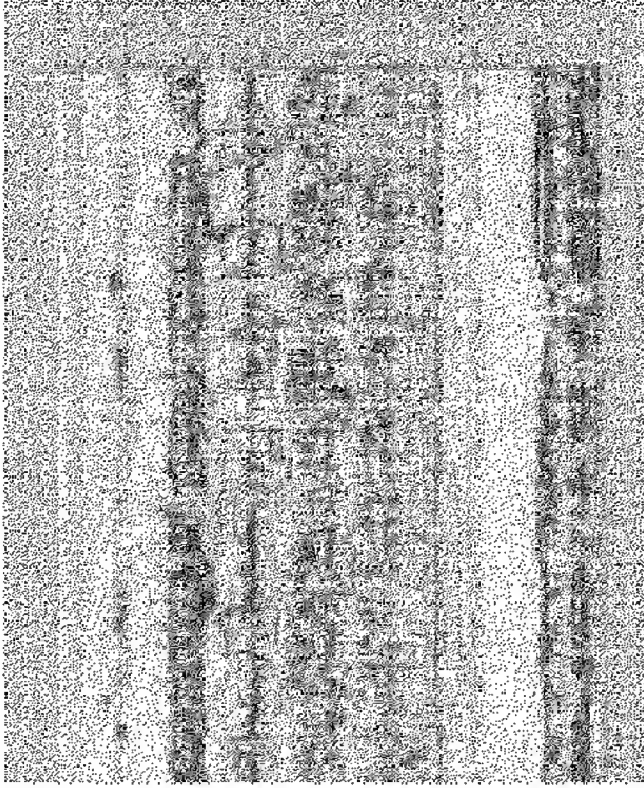
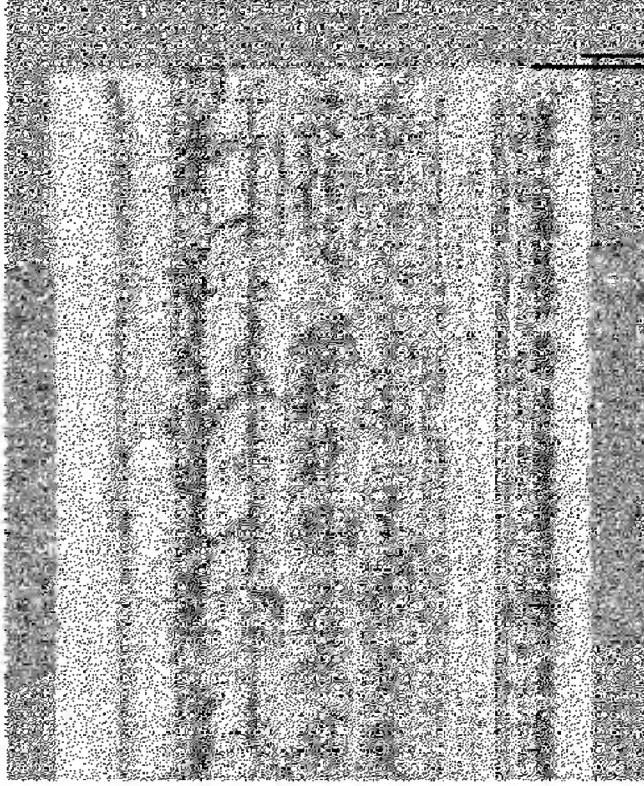
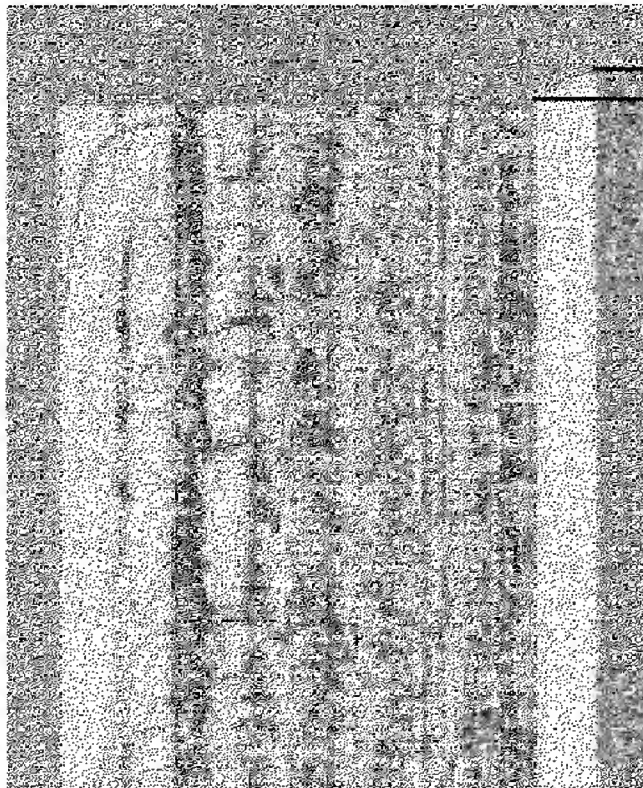


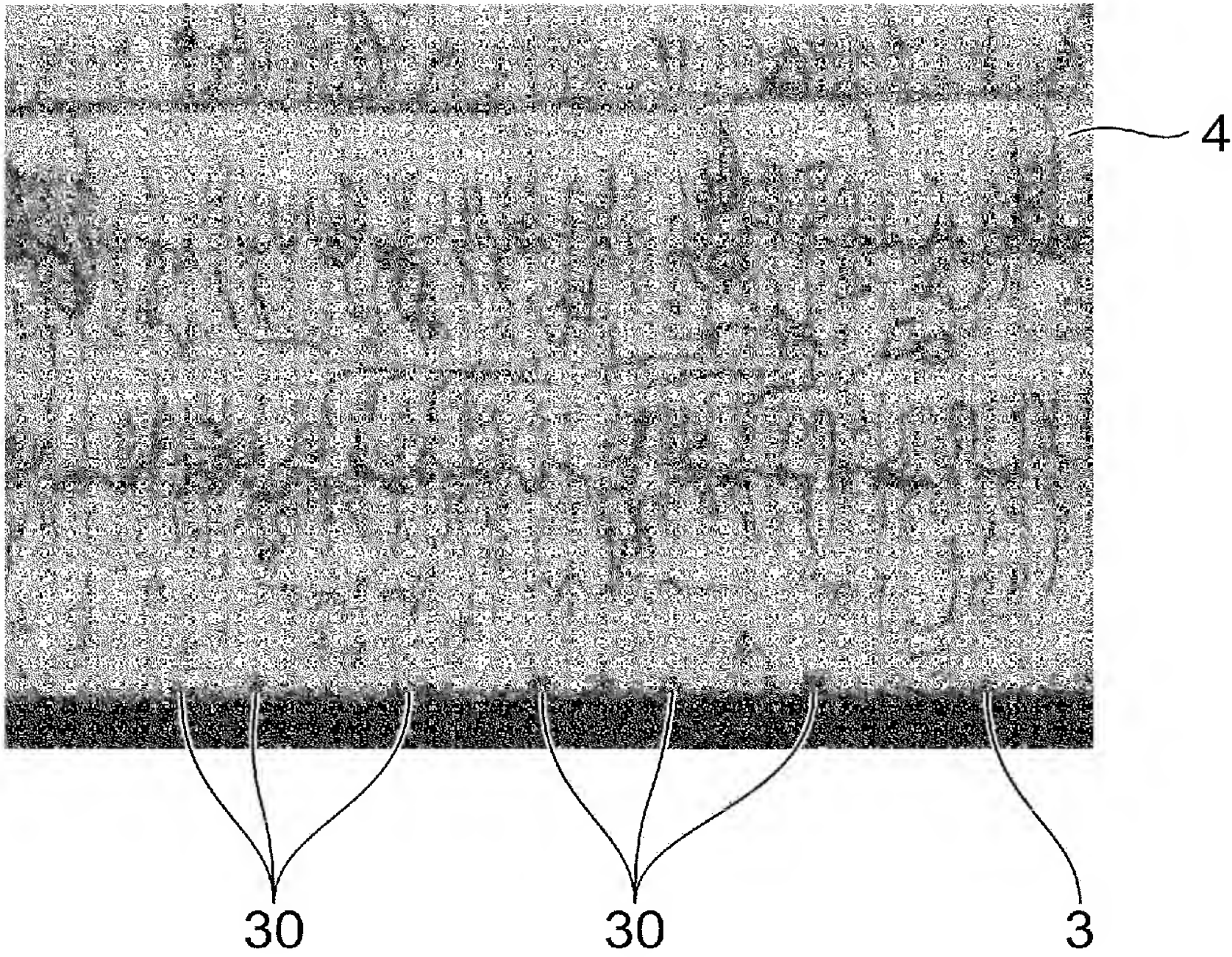


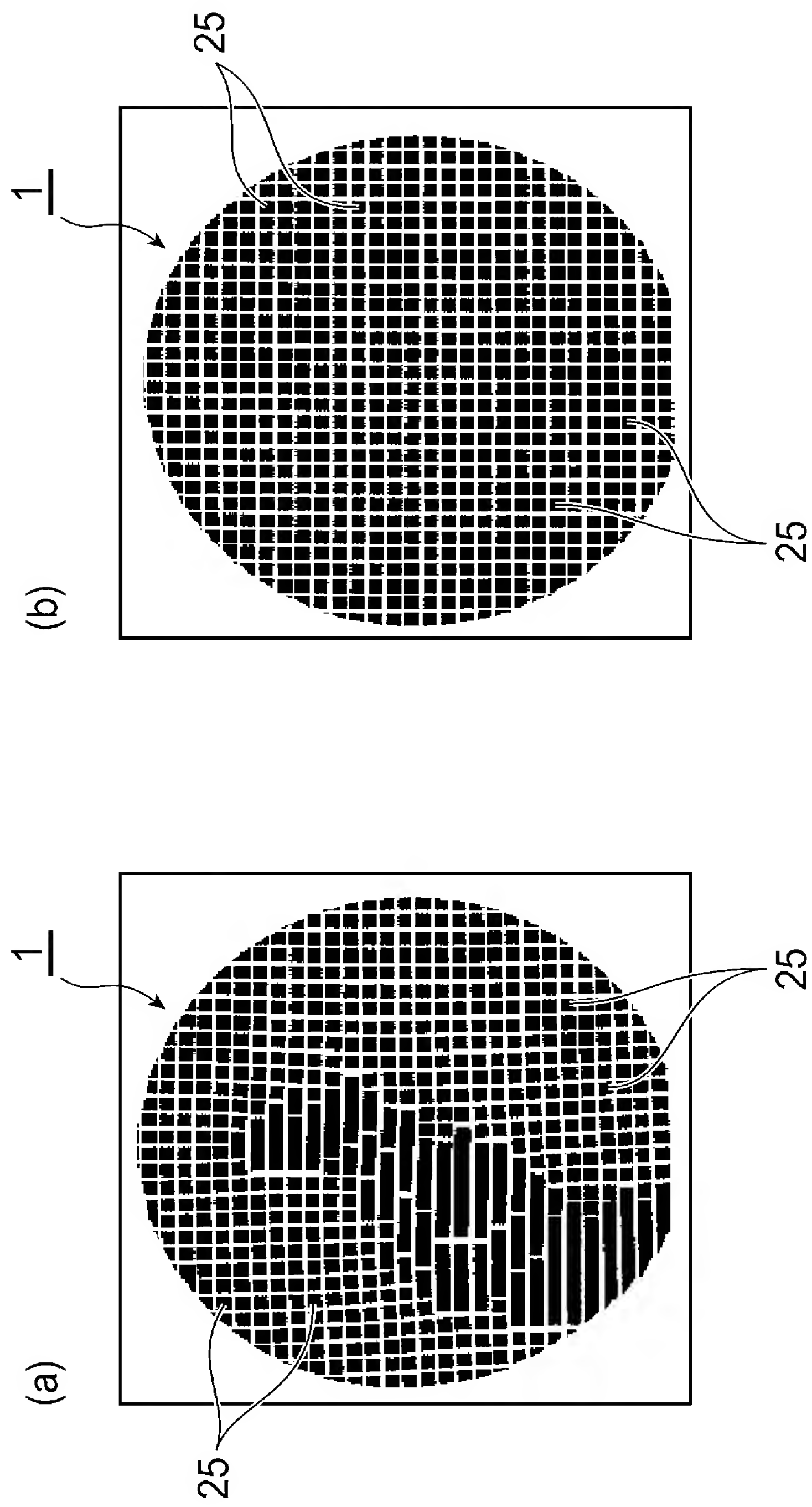


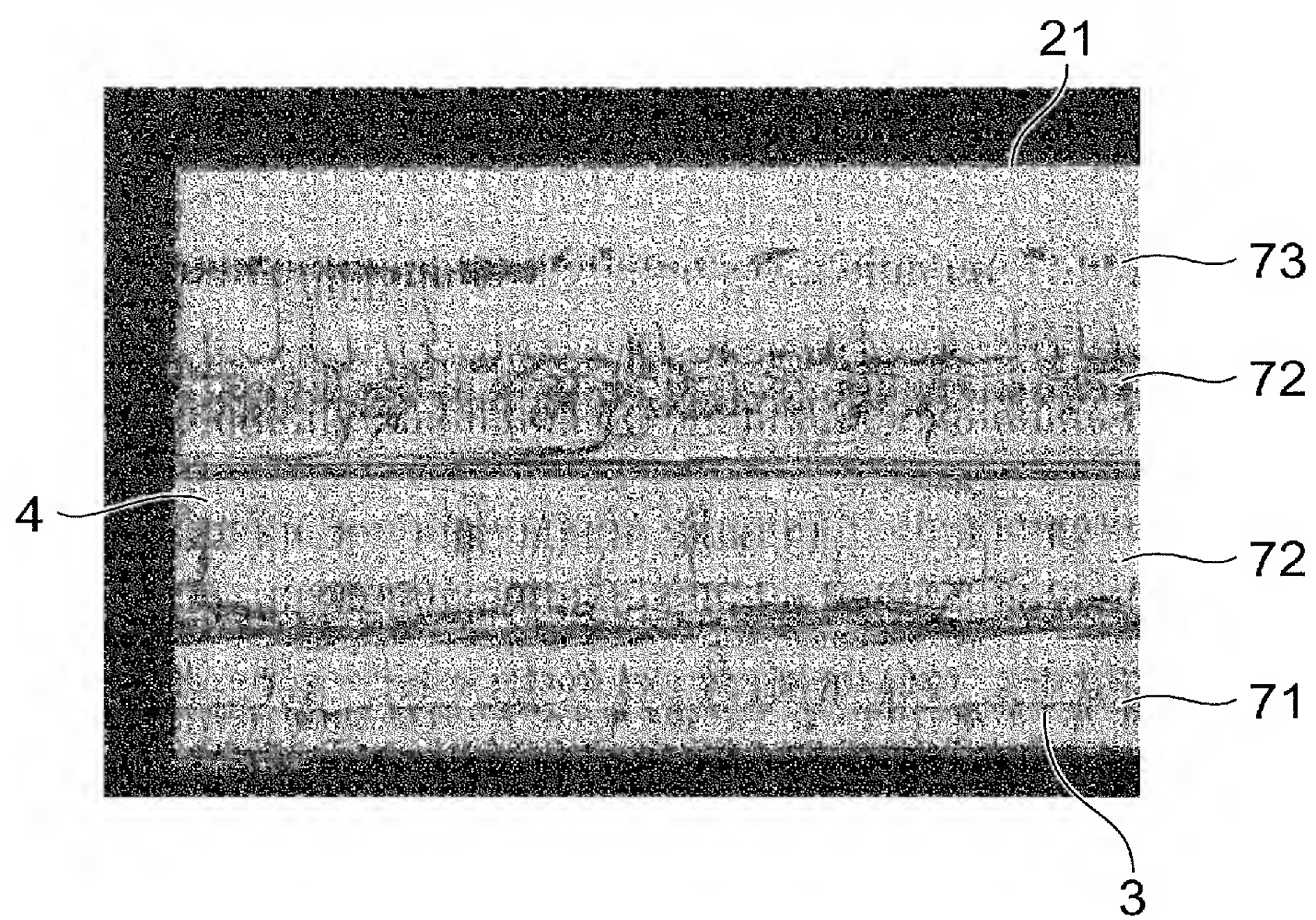


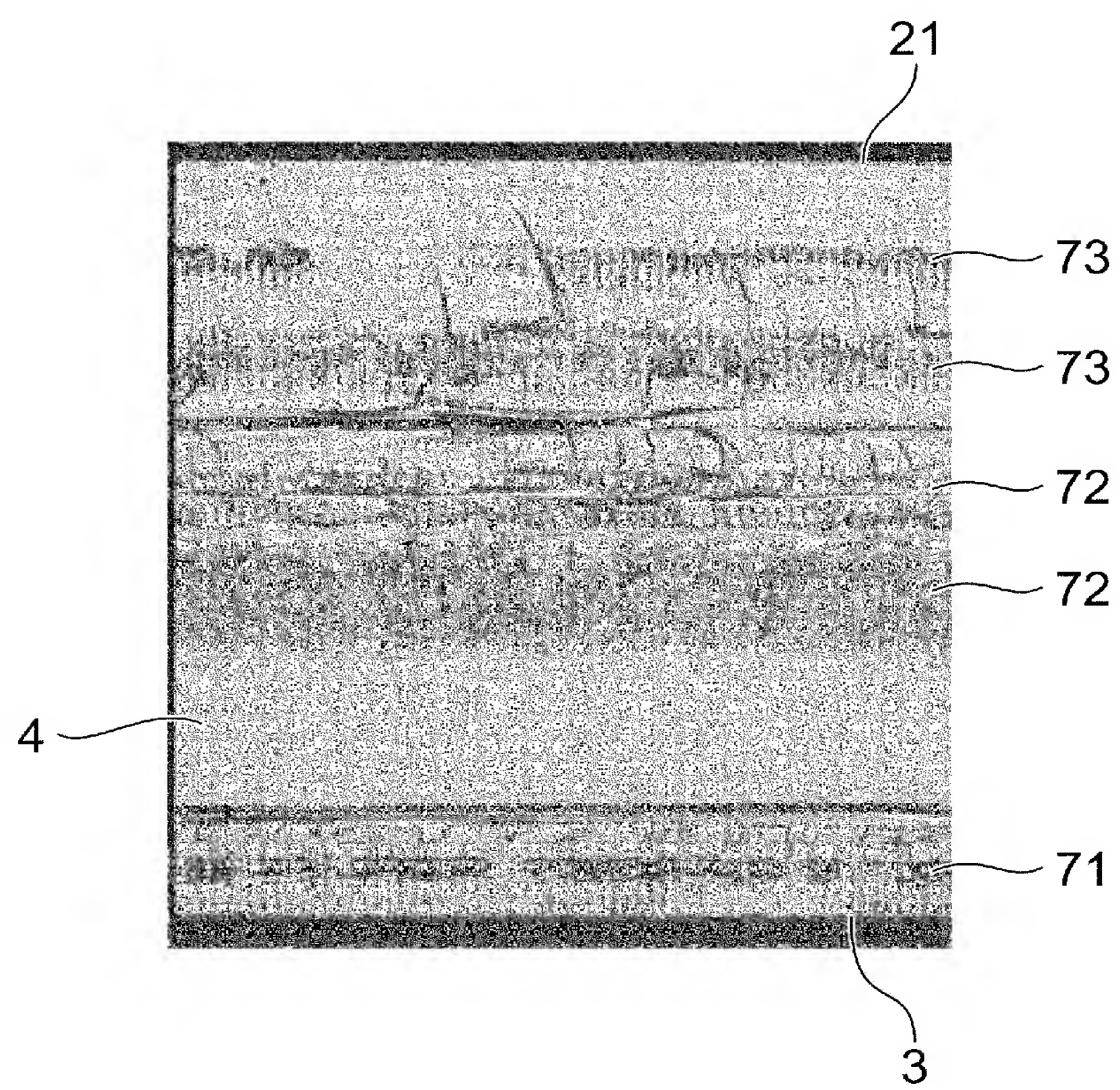


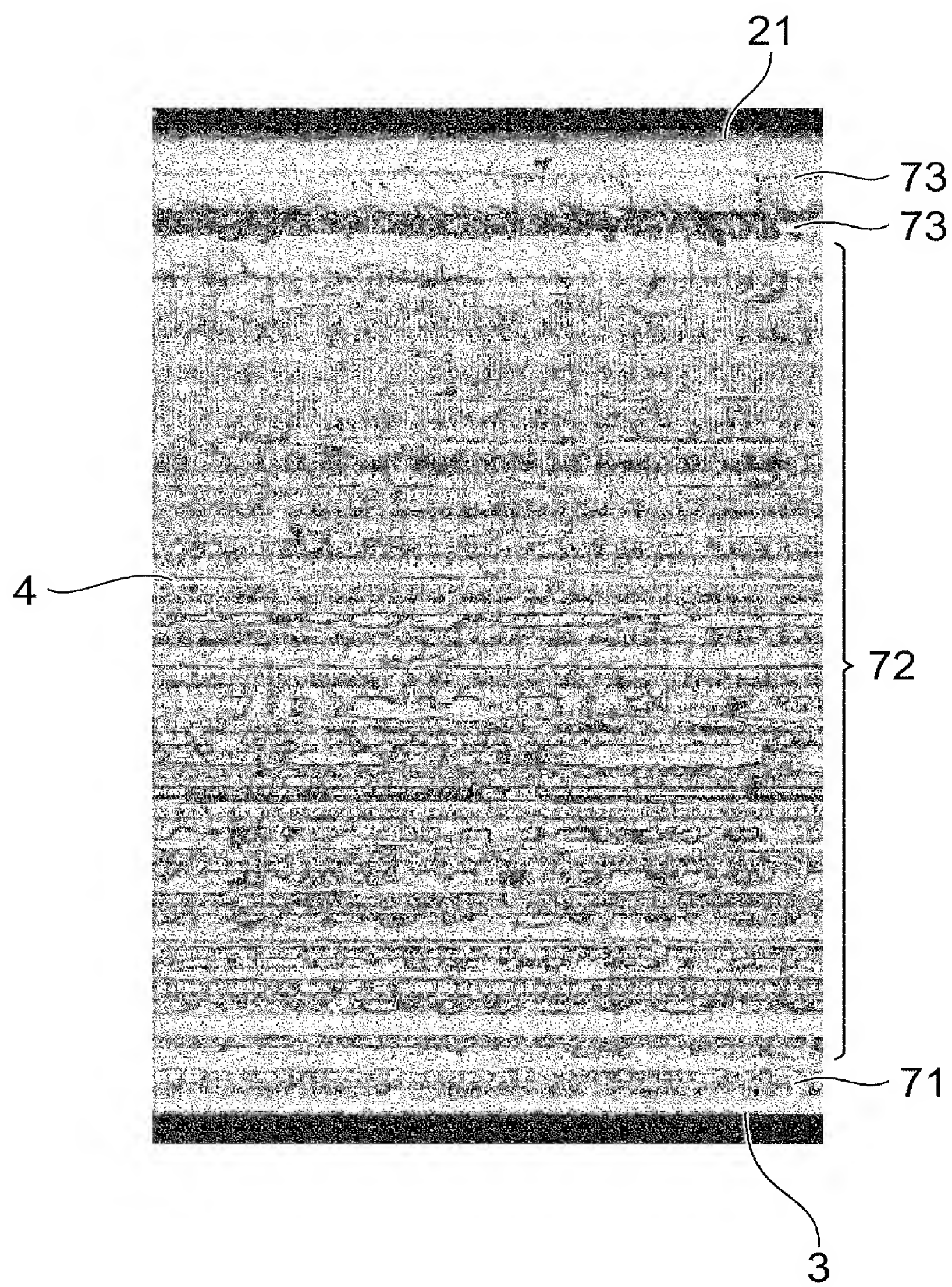
集光点位置／エネルギー	267 μm ／15 μJ	249 μm ／15 μJ
品質改質領域の 裏面側端部位置／幅／表面側端部位置	276 μm ／17 μm ／7 μm	257 μm ／19 μm ／20 μm
切断面画像（ $\times 100$ 倍） 上側：裏面（レーザー光入射面） 下側：表面（デバイス面）		
スカート幅 S	0 μm	4 μm
集光点位置／エネルギー	231 μm ／15 μJ	品質改質領域なし
品質改質領域の 裏面側端部位置／幅／表面側端部位置	232 μm ／20 μm ／45 μm	
切断面画像（ $\times 100$ 倍） 上側：裏面（レーザー光入射面） 下側：表面（デバイス面）		
スカート幅 S	20 μm	16 μm











【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数の機能素子を含む積層部が形成された基板が厚い場合であっても、基板及び積層部の高精度な切断を可能にするレーザ加工方法を提供する。

【解決手段】 このレーザ加工方法では、裏面 2 1 をレーザ光入射面として基板 4 の内部に集光点 P を合わせてレーザ光 L を照射することで、改質領域 7 1 , 7 2 , 7 3 を基板 4 の内部に形成する。このとき、裏面 2 1 に最も近い分断改質領域 7 2 と裏面 2 1 との間の位置に H C 改質領域 7 3 を形成することで、切断予定ラインに沿った割れ 2 4 を H C 改質領域 7 3 から裏面 2 1 に生じさせている。これにより、エキスパンドテープを基板 4 の裏面 2 1 に貼り付けて拡張させると、分断改質領域 7 2 を介して基板 4 から積層部 1 6 へとスムーズに割れが進行することとなり、その結果、基板 4 及び積層部 1 6 を切断予定ラインに沿って精度良く切断することができる。

【選択図】 図 1 6

出 願 人 履 歴

0 0 0 2 3 6 4 3 6

19900810

新規登録

静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1

浜松ホトニクス株式会社